

심층분석보고서

26하_SK하이닉스_영업

마감일: 8월26일17시00분

| 노영우 컨설턴트 & 취업 플랫폼 '룩센트'

■ Executive Summary

2026년 6월 현재, SK하이닉스는 메모리 반도체 산업의 역사에서 전례를 찾기 어려운 국면 한가운데 서 있습니다. 2026년 1분기 매출은 52조 5,763억 원, 영업이익은 37조 6,103억 원으로 영업이익률 72%를 기록했습니다. 불과 세 분기 전인 2025년 2분기 매출이 22조 2,320억 원, 영업이익이 9조 2,129억 원이었다는 점을 떠올리면, 이 회사의 손익 구조가 얼마나 급격히 재편되었는지 가늠할 수 있습니다. 제조업에서 영업이익률 70%대는 통상적으로 관찰되지 않는 수치이며, 이는 메모리가 범용 부품에서 공급이 제한된 전략 물자에 가까운 성격으로 이동했음을 보여 줍니다.

이 변화를 이끈 것은 인공지능 가속기용 고대역폭메모리, 즉 HBM입니다. 카운터포인트리서치 집계 기준 SK하이닉스는 2026년 1분기 HBM 매출 점유율 58%를 확보하며 시장의 과반을 유지했고, 2025년 1분기에는 D램 매출 점유율 36%로 삼성전자의 34%를 앞질러 사상 처음 D램 1위에 올랐습니다. 주목할 지점은 이익 기여 구조입니다. 2025년 1분기 기준 HBM은 회사 D램 출하량의 14%에 불과했으나 D램 매출의 44%, D램 영업이익의 54%를 만들어 냈습니다. 적은 물량이 이익 대부분을 창출하는 극단적 프리미엄 구조가 자리 잡은 것입니다.

시장 전망도 가파릅니다. TrendForce는 2026년 글로벌 메모리 시장을 5,516억 달러, 2027년을 8,427억 달러로 추정하며, 이 가운데 D램이 2026년 4,043억 달러로 전년 대비 144% 증가할 것으로 봅니다. 세계반도체무역통계기구도 2026년 메모리 시장을 2,948억 달러, 전년 대비 39.4% 증가로 전망했습니다. 다만 이 성장의 성격을 정확히 읽어야 합니다. 물량이 아니라 가격이 만든 성장이며, PC와 스마트폰으로 향하던 물량은 오히려 줄고 있습니다. 가트너는 2026년 메모리 가격 급등의 여파로 PC 출하량이 10.4%, 스마트폰 출하량이 8.4% 감소할 것으로 내다봤습니다.

경쟁 구도는 다시 요동치고 있습니다. 삼성전자는 HBM3E 국면에서 잃은 주도권을 HBM4에서 되찾으려 하고 있고, 마이크론은 미국 정부 지원과 대규모 현지 증설을 동력 삼아 추격 중이며, 창신메모리와 양쯔메모리는 레거시 영역을 잠식하며 점유율을 넓히고 있습니다. HBM 출하량 기준으로 보면 삼성전자는 2024년 2분기 41%에서 2025년 2분기 17%로 급락했고, 같은 기간 마이크론은 4%에서 21%로 올라섰습니다. HBM4 세대는 SK하이닉스의 독주가 복점 또는 삼분 구도로 완화된 첫 세대가 될 개연성이 있습니다.

이 보고서가 다루는 직무는 이러한 산업 재편의 최전선에 놓여 있습니다. 상품기획, 신제품 사업화, 마케팅, 영업으로 나뉜 네 갈래는 각각 무엇을 만들지 정의하고, 고객 인증을 통과시키며, 어떻게 팔지 설계하고, 실제 매출로 연결하는 일을 맡습니다. 광노정 최고경영자가 2025년 11월 선언한 Full Stack AI Memory Creator라는 표현은 고객이 원하는 제품을 적기에 공급하던 위치에서 고객의 문제를 함께 푸는 공동 설계자로 이동하겠다는 선언이며, 이는 이 직무의 성격 변화를 그대로 반영합니다. 한정된 생산 능력을 어느 고객과 어느 제품에 배분할지 결정하는 일이 곧 회사의 이익률을 좌우하는 국면에서, 수요 예측과 가격 협상과

인증 관리의 무게는 과거 어느 때보다 무겁습니다.

■ 1장: 산업(섹터) 분석

● 1-1. 메모리 반도체라는 산업의 정의와 경계

반도체 산업을 이해하려면 먼저 큰 구획을 나눠야 합니다. 반도체는 크게 연산과 제어를 담당하는 시스템 반도체, 그리고 데이터를 기억하고 저장하는 메모리 반도체로 나뉩니다. 시스템 반도체는 중앙처리장치, 그래픽처리장치, 통신칩, 이미지센서, 전력반도체 등 종류가 수천 가지에 이르고 각 제품이 고객 맞춤형으로 설계되는 경우가 많습니다. 반면 메모리 반도체는 제품 종류가 상대적으로 적고 규격이 국제 표준으로 통일되어 있으며, 같은 규격의 제품을 대량으로 찍어 내 원가를 낮추는 경쟁이 벌어집니다.

이 차이는 산업의 성격을 근본적으로 갈라놓습니다. 시스템 반도체는 설계 역량과 고객 관계가 진입 장벽이 되고, 메모리 반도체는 공정 기술과 설비 투자 규모가 진입 장벽이 됩니다. 메모리는 표준품이기 때문에 A사 제품과 B사 제품이 원칙적으로 호환되며, 그 결과 가격이 시장 수급에 따라 크게 출렁입니다. 곡물이나 원유처럼 거래소 시세에 가까운 성격을 갖는 것입니다. 그런데 2020년대 중반 들어 이 전제가 흔들리기 시작했습니다. HBM처럼 고객 시스템에 깊이 결합되는 제품이 등장하면서, 메모리의 일부 영역이 표준품에서 맞춤형으로 이동하고 있습니다. 이 이동이 이 보고서 전체를 관통하는 핵심 변화입니다.

SK하이닉스가 속한 시장의 경계를 좀 더 좁혀 보면, 회사의 사업은 D램과 낸드플래시라는 두 갈래로 구성되고, 그 위에 HBM과 기업용 솔리드스테이트드라이브라는 고부가 제품군이 얹혀 있습니다. 여기에 자회사 솔리다임이 기업용 저장장치 영역을 담당합니다. 이 구성은 경쟁사와 비교할 때 의미가 분명해집니다. 삼성전자는 메모리에 더해 시스템반도체 설계와 파운드리를 함께 보유하고, 마이크론은 메모리에 집중하되 미국 내 생산 기반을 강점으로 삼으며, 키옥시아는 낸드에만 특화되어 있습니다. SK하이닉스는 메모리 전업이면서 D램과 낸드를 모두 보유하고, 그중에서도 고부가 D램에 무게중심이 크게 쏠린 회사입니다.

● 1-2. D램의 작동 원리와 제품 계층

D램은 Dynamic Random Access Memory의 약자입니다. 용어를 네 단계로 풀어 보겠습니다.

첫째, 용어 자체는 동적 임의접근 기억장치를 뜻합니다. 둘째, 쉬운 정의로는 전원이 켜져 있는 동안에만 정보를 담아 두는 임시 작업 공간입니다. 컴퓨터가 지금 이 순간 다루고 있는 데이터를 펼쳐 놓는 책상에 해당합니다. 책상이 넓으면 여러 서류를 동시에 펼쳐 놓을 수 있고, 손이 빠르면 서류를 집었다 놓는 속도가 빨라집니다. 셋째, 산업에서 중요한 이유는 연산 장치의 성능이 아무리 좋아져도 데이터를 넣고 빼는 속도가 따라오지 못하면 전체 성능이 제자리를 맴돌기 때문입니다. 이 병목을 업계에서는 메모리 월이라 부릅니다. 넷째, 이 회사와

직무 맥락에서 보면 D램은 SK하이닉스 매출의 대략 3분의 2를 차지하는 주력 제품군이며, 마케팅과 영업 조직은 이 D램을 응용처별로 나누어 담당합니다.

D램은 어디에 쓰이느냐에 따라 계층이 나뉩니다. 서버용 D램은 데이터센터 서버에 꽂히는 모듈 형태로 공급되며 신뢰성과 용량이 중요합니다. PC용 D램은 개인용 컴퓨터에, 모바일용 저전력 D램은 스마트폰과 태블릿에 들어가며 전력 효율이 관건입니다. 그래픽용 D램은 게임용 그래픽카드와 일부 가속기에 쓰이고 대역폭이 핵심입니다. 그리고 HBM은 이들 위에 별도 계열로 존재합니다.

이 구분이 실무에서 중요한 이유는 조직 구조와 직결되기 때문입니다. 메모리 회사의 마케팅 조직은 통상 응용처별로 나뉘어 있고, 담당자마다 상대하는 고객군과 가격 협상 주기가 다릅니다. 서버용 D램 담당자는 북미 하이퍼스케일러와 서버 제조사를 상대하고, 모바일 D램 담당자는 한국과 중화권 스마트폰 제조사를 상대합니다. 같은 회사 안에서도 완전히 다른 시장을 보는 셈입니다.

● 1-3. 낸드플래시의 작동 원리와 제품 계층

낸드플래시는 전원이 꺼져도 정보가 남는 비휘발성 메모리입니다. 네 단계로 풀어 보겠습니다.

첫째, 용어는 낸드 게이트 구조를 활용한 플래시 메모리를 뜻합니다. 둘째, 쉬운 정의로는 작업이 끝난 서류를 넣어 두는 서랍이나 창고에 해당합니다. 책상인 D램과 달리 전원을 꺼도 내용이 사라지지 않고 용량이 훨씬 큼니다. 대신 데이터를 넣고 빼는 속도는 D램보다 느립니다. 셋째, 산업에서 중요한 이유는 스마트폰의 저장 공간, 노트북의 솔리드스테이트드라이브, 데이터센터의 대용량 저장 장치가 모두 낸드로 만들어지기 때문입니다. 넷째, 이 회사와 직무 맥락에서 낸드는 오랫동안 D램에 비해 수익성이 낮은 사업으로 취급되었으나, 인공지능 추론이 확산되며 방대한 데이터를 저장하고 꺼내 쓰는 수요가 폭증하면서 재평가받고 있습니다.

낸드의 기술 경쟁은 두 방향으로 진행됩니다. 하나는 셀을 얼마나 높이 쌓느냐입니다. 초기에는 평면으로 배치했으나 미세화가 한계에 부딪히자 위로 쌓기 시작했고, 2026년 현재 300단을 넘는 제품이 양산 영역에 들어와 있습니다. 다른 하나는 한 칸에 몇 비트를 담느냐입니다. 한 칸에 1비트를 담으면 SLC, 2비트면 MLC, 3비트면 TLC, 4비트면 QLC라 부릅니다. 칸당 담는 정보가 많아질수록 같은 면적에 더 많이 저장할 수 있어 원가가 내려가지만, 읽고 쓰는 속도와 수명이 나빠집니다.

QLC를 네 단계로 풀면 이렇습니다. 첫째, 용어는 한 셀에 4비트를 담는 방식입니다. 둘째, 쉬운 정의로는 한 칸짜리 서랍에 칸막이를 여러 겹 넣어 물건을 촘촘히 넣는 방식입니다. 많이 들어가지만 꺼낼 때 헛갈릴 여지가 커집니다. 셋째, 산업적으로는 대용량 저장 장치의 원가를 크게 낮출 수 있어 인공지능 데이터센터에 적합합니다. 넷째, SK하이닉스는 300단대 QLC 기반 저장 장치를 앞세워 이 시장을 공략하고 있으며, 솔리다임이 보유한 고용량 제품군과 결합해

포트폴리오를 넓히고 있습니다.

● 1-4. HBM, 메모리 산업의 규칙을 바꾼 제품

HBM은 High Bandwidth Memory의 약자로 고대역폭메모리를 뜻합니다. 이 제품을 이해하지 못하면 2026년의 메모리 산업을 이해할 수 없습니다. 네 단계로 충실히 풀어 보겠습니다.

첫째, 용어는 대역폭이 넓은 메모리라는 뜻입니다. 대역폭이란 단위 시간에 오갈 수 있는 데이터의 양을 말합니다. 둘째, 쉬운 정의로는 D램 여러 장을 수직으로 쌓아 올린 뒤 층마다 구멍을 뚫어 위아래를 관통하는 통로를 만들고, 그 통로로 데이터를 한꺼번에 주고받게 만든 제품입니다. 일반 D램이 2차선 도로라면 HBM은 수천 차선 도로에 가깝습니다. 도로를 옆으로 계속 넓힐 수 없으니 위로 쌓아 올린 입체 교차로를 만든 셈입니다. 셋째, 산업에서 중요한 이유는 인공지능 연산의 성격 때문입니다. 인공지능 모델은 막대한 규모의 수치 데이터를 반복해서 읽고 쓰는데, 연산 장치가 아무리 빨라도 데이터가 제때 도착하지 않으면 노는 시간이 생깁니다. HBM은 그 대기 시간을 없애 주는 부품이며, 그래서 인공지능 가속기 한 장에 여러 개가 함께 붙습니다. 넷째, 이 회사와 직무 맥락에서 HBM은 SK하이닉스를 만년 2위에서 D램 1위로 끌어올린 제품이자, 마케팅과 영업 조직이 다루는 협상의 성격을 바꿔 놓은 제품입니다. 표준품 시절에는 분기마다 가격을 흥정했지만, HBM은 여러 분기 또는 연 단위로 물량과 가격을 미리 정하고 고객의 개발 일정에 맞춰 공급 계획을 짭니다.

HBM의 세대는 HBM, HBM2, HBM2E, HBM3, HBM3E, HBM4 순으로 진화해 왔습니다. 2026년 상반기 현재 시장의 초점은 HBM4에 있습니다. HBM4는 이전 세대와 결정적으로 다른 점이 있는데, 메모리 더미 맨 아래에 놓여 신호를 정리하고 제어하는 베이스 다이가 사실상 로직 반도체 수준으로 복잡해졌다는 것입니다. 이 때문에 메모리 회사가 파운드리 회사와 협업해야 하는 구조가 생겼고, SK하이닉스는 TSMC의 로직 공정을 활용하는 방식을 선택했습니다. 순수한 종합반도체기업 모델에서 협업형 모델로 이동한 것이며, 이 변화는 상품기획과 신제품 사업화 조직이 외부 파트너를 조율해야 하는 업무를 새로 만들어 냈습니다.

HBM 시장 규모는 SK하이닉스 자체 추정 기준 2025년 346억 달러에서 2026년 546억 달러로 58% 증가할 것으로 전망됩니다. 전체 D램 시장에서 차지하는 비중은 물량 기준으로 보면 여전히 작지만, 금액과 이익 기준으로 보면 이미 지배적입니다. 2025년 1분기 SK하이닉스 기준으로 HBM은 D램 출하량의 14%에 그쳤으나 D램 매출의 44%, D램 영업이익의 54%를 담당했습니다. 같은 기간 HBM과 서버용 D램을 합친 매출 비중은 77%까지 올라갔습니다. 회사의 손익이 인공지능 데이터센터라는 하나의 수요처에 크게 의존하게 되었다는 뜻이며, 이는 강점인 동시에 위험 요인입니다.

● 1-5. TSV와 MR-MUF, HBM을 가능하게 만든 공정 기술

HBM을 만들려면 D램 칩에 구멍을 뚫어 위아래를 연결해야 합니다. 이 기술을 실리콘 관통 전극, 영어로 TSV라 부릅니다. 네 단계로 풀면, 첫째 용어는 실리콘 웨이퍼를 수직으로 관통하는 전극을 뜻합니다. 둘째, 쉬운 정의로는 여러 층 건물을 지을 때 각 층을 잇는

엘리베이터 통로를 미리 뚫어 놓는 작업입니다. 셋째, 산업적으로 중요한 이유는 이 통로가 있어야 층을 쌓아도 신호가 빠르게 오갈 수 있기 때문입니다. 통로 없이 옆으로 배선을 돌리면 거리가 길어져 속도와 전력 효율이 나빠집니다. 넷째, 이 회사 맥락에서 TSV 공정은 웨이퍼 한 장에서 나오는 완제품 수를 줄이는 요인이기도 합니다. 구멍을 뚫고 쌓는 과정에서 손실이 생기고 여러 장의 칩이 하나의 제품으로 묶이기 때문에, HBM 1기가바이트를 만드는데 일반 D램보다 훨씬 많은 웨이퍼가 소모됩니다.

여기에 SK하이닉스의 독자 기술로 알려진 MR-MUF가 얹힙니다. 첫째, 용어는 대량 리플로우 몰디드 언더필의 약자입니다. 둘째, 쉬운 정의로는 칩을 층층이 쌓은 뒤 층 사이 빈 공간에 보호재를 흘려 넣고 한 번에 굳혀 고정하는 방식입니다. 유리판을 여러 장 겹쳐 놓고 사이사이에 투명한 젤을 부어 한꺼번에 굳히는 모습을 떠올리면 됩니다. 셋째, 산업적으로 중요한 이유는 층을 쌓을수록 열이 빠져나가기 어렵고 구조가 휘기 쉬운데, 이 방식이 열 배출과 구조 안정성을 함께 해결했기 때문입니다. 넷째, 이 회사와 직무 맥락에서 MR-MUF는 고객에게 제품 우위를 설명할 때 쓰이는 핵심 논거입니다. 기술 자체는 개발 조직이 만들지만, 그 기술이 왜 고객의 시스템에서 이점이 되는지를 언어로 옮겨 전달하는 일은 마케팅과 상품기획 조직의 몫입니다.

● 1-6. 반도체 가치사슬과 그 안에서 메모리 회사의 위치

반도체 산업의 가치사슬은 크게 다섯 구간으로 나뉩니다.

설계 전문 회사는 팹리스라 부릅니다. 공장 없이 설계만 하며, 엔비디아, 퀄컴, 브로드컴, AMD 등이 여기 속합니다. 위탁 생산 전문 회사는 파운드리라 부르며 TSMC가 압도적 1위입니다. 후공정 패키징과 테스트를 맡는 회사는 OSAT라 부릅니다. 소재, 부품, 장비를 공급하는 회사들은 소부장이라 통칭하며, 노광 장비의 ASML, 증착과 식각 장비의 어플라이드머티리얼즈와 램리서치, 도교일렉트론 등이 있습니다. 그리고 설계부터 생산과 판매까지 스스로 수행하는 회사를 종합반도체기업, 영어로 IDM이라 부릅니다.

IDM을 네 단계로 풀면, 첫째 용어는 통합 소자 제조사를 뜻합니다. 둘째, 쉬운 정의로는 요리법 개발부터 조리과 판매까지 한 회사가 도맡는 직영 식당에 비유할 수 있습니다. 셋째, 산업적으로 중요한 이유는 메모리처럼 표준 제품을 대량으로 만들어 원가를 낮추는 게임에서는 설계와 공정을 함께 최적화하는 수직 통합이 유리하기 때문입니다. 설계 담당자가 공정의 한계를 알고 설계하고, 공정 담당자가 설계 의도를 알고 조건을 잡을 때 수율이 올라갑니다. 넷째, 이 회사 맥락에서 SK하이닉스는 메모리 IDM이면서도 HBM4 베이스 다이는 TSMC에 맡기는 혼합 구조를 택했습니다. 완전 자급이 아니라 필요한 곳에서 외부 역량을 끌어 쓰는 개방형 모델로 이동한 것입니다.

메모리 회사의 핵심 수익 지점은 명확합니다. 비트당 생산 원가와 비트당 판매 가격의 차이입니다. 원가를 낮추는 수단은 미세공정 전환과 적층 단수 증가, 수율 개선입니다. 가격을 높이는 수단은 고부가 제품 비중 확대와 협상력 강화입니다. 이 두 갈래가 만나는 지점에서 이익이 결정되며, 마케팅과 영업 조직은 후자를 담당합니다.

● 1-7. 가격과 물량을 읽는 두 지표, ASP와 비트그로스

메모리 산업의 대화는 두 지표를 중심으로 돌아갑니다.

첫 번째는 ASP입니다. 첫째, 용어는 평균 판매 가격을 뜻하는 Average Selling Price의 약자입니다. 둘째, 쉬운 정의로는 판매한 제품 전체의 매출을 판매 수량으로 나눈 값입니다. 같은 쌀이라도 작황과 수요에 따라 가마니당 시세가 달라지듯, 메모리도 수급에 따라 가격이 오르내립니다. 셋째, 산업적으로 중요한 이유는 메모리 회사의 분기 실적이 ASP 변동에 크게 좌우되기 때문입니다. 물량이 그대로여도 가격이 절반으로 떨어지면 매출이 절반이 되고, 고정비가 그대로 남아 있으므로 이익은 그보다 훨씬 크게 줄어듭니다. 넷째, 이 회사와 직무 맥락에서 영업과 마케팅 조직의 분기 가격 협상 결과가 곧 ASP이며, 이는 조직 성과 지표의 핵심을 이룹니다.

두 번째는 비트그로스입니다. 첫째, 용어는 판매하거나 생산한 메모리의 총 용량을 비트 단위로 환산해 그 증가율을 나타낸 지표입니다. 둘째, 쉬운 정의로는 매출을 돈이 아니라 데이터의 양으로 세는 방식입니다. 셋째, 산업적으로 중요한 이유는 가격 변동이 심한 산업에서 물량 성장의 실체를 파악하려면 금액과 별개의 잣대가 필요하기 때문입니다. 넷째, 이 회사와 직무 맥락에서 수요 예측 회의와 생산 계획 회의는 비트 단위로 이루어지며, 이 언어에 익숙하지 않으면 회의 내용을 따라가기 어렵습니다.

두 지표의 관계는 미묘합니다. 호황기에는 가격이 오르므로 물량을 늘리지 않아도 매출이 늘고, 불황기에는 가격이 내려가므로 물량을 늘려도 매출이 줄어듭니다. 그래서 메모리 회사는 호황기에 무리하게 물량을 늘리기보다 고부가 제품으로 무게중심을 옮기는 선택을 하기도 합니다. 2026년 상반기 SK하이닉스가 보여 준 모습이 정확히 그렇습니다.

● 1-8. 사이클은 왜 생기고 어떻게 작동하는가

메모리 산업이 주기적으로 크게 출렁이는 이유는 수요와 공급의 반응 속도가 다르기 때문입니다.

수요는 빠르게 변합니다. 경기가 좋아지면 기업이 서버를 늘리고 소비자가 기기를 바꿉니다. 반대로 경기가 나빠지면 구매를 미룹니다. 이 변화는 몇 달 안에 일어납니다. 반면 공급은 느리게 변합니다. 공장을 새로 지으려면 3년 안팎이 걸리고, 장비를 들여놓고 수율을 안정시키는 데 다시 시간이 필요합니다. 이미 지어진 공장은 멈추면 손실이 크므로 가격이 떨어져도 쉽게 세우지 못합니다.

그 결과 다음과 같은 흐름이 반복됩니다. 수요가 늘어 가격이 오르면 회사들이 이익을 내고, 그 이익으로 증설에 나섭니다. 증설한 설비가 가동될 무렵이면 수요 증가세가 이미 꺾여 있는 경우가 많고, 그러면 공급이 남아 가격이 급락합니다. 가격이 원가 밑으로 내려가면 회사들이 감산에 들어가고 투자를 줄입니다. 그 상태로 시간이 흐르면 재고가 소진되고 수요가 회복되며 다시 가격이 오릅니다.

2023년의 대규모 적자와 2024년 이후의 급격한 회복이 이 흐름을 보여 줍니다. 2023년 SK하이닉스는 대규모 영업손실을 기록하며 감산에 나섰고, 인공지능 수요가 폭발한 2024년 이후에는 감산을 되돌리고 증설로 전환했습니다. 2026년 현재의 논쟁은 이번 국면이 과거와 같은 순환인지, 아니면 인공지능이라는 새로운 수요가 구조적으로 자리 잡아 사이클의 진폭 자체가 달라진 것인지에 있습니다.

● 1-9. 2026년 상반기 시장 규모와 가격 동향

2026년 6월 현재 확인 가능한 수치를 정리하면 다음과 같습니다.

TrendForce는 글로벌 메모리 시장 규모를 2026년 5,516억 달러, 2027년 8,427억 달러로 전망합니다. 2027년 성장률은 53%에 이릅니다. 이 가운데 D램은 2026년 4,043억 달러로 전년 대비 144% 증가하고, 낸드는 1,473억 달러로 112% 증가할 것으로 봅니다. 세계반도체무역통계기구도 2026년 전체 반도체 시장을 9,754억 6,000만 달러로 전년 대비 26.3% 증가, 그중 메모리를 2,948억 2,000만 달러로 전년 대비 39.4% 증가로 전망했습니다. 두 기관의 수치가 차이 나는 것은 집계 범위와 가격 가정이 다르기 때문이며, 방향성은 일치합니다.

가격 흐름은 더 극적입니다. TrendForce 집계 기준 2026년 1분기 일반 D램 계약 가격은 전 분기 대비 90%에서 95% 상승했고, 낸드는 55%에서 60% 상승했습니다. 2분기에는 D램이 58%에서 63%, 낸드가 70%에서 75% 상승할 것으로 전망되며, 3분기에는 상승 폭이 완만해져 D램 13%에서 18%, 낸드 10%에서 15% 수준으로 예상됩니다. 상승 폭이 줄어드는 이유는 소비자 수요가 가격 급등에 반응해 위축되고 있고, 전년 대비 기저가 이미 높아졌기 때문입니다.

여기서 중요한 해석이 필요합니다. 이 성장은 물량이 만든 성장이 아닙니다. 가트너는 2026년 PC 출하량이 10.4%, 스마트폰 출하량이 8.4% 감소할 것으로 전망했습니다. 메모리 가격이 오르면 완제품 제조사가 원가 부담을 이기지 못해 생산을 줄이거나 탑재 용량을 줄이고 있는 것입니다. 다시 말해 메모리 회사가 벌어들이는 이익의 상당 부분은 완제품 산업의 부담에서 나오고 있으며, 이는 지속 가능성에 관한 논쟁의 출발점이 됩니다.

● 1-10. 최근 5년의 구조적 변화, 다섯 갈래

첫 번째 갈래는 HBM의 등장과 판도 전환입니다. 2022년 SK하이닉스가 HBM3를 엔비디아 가속기에 공급하면서 시작된 흐름은 2025년 1분기 D램 매출 1위 교체라는 결과로 이어졌습니다. 카운터포인트 추정 기준 SK하이닉스 36%, 삼성전자 34%였습니다.

두 번째 갈래는 학습에서 추론으로의 수요 이동입니다. 인공지능 모델을 만드는 단계인 학습에서는 HBM과 가속기가 핵심이었지만, 만들어진 모델을 실제 서비스에 쓰는 추론 단계로 넘어가면서 서버용 D램과 기업용 저장 장치까지 수요가 번졌습니다. 추론은 학습보다 훨씬 많은 서버에서 훨씬 오래 돌아가기 때문에, 수요의 저변이 넓어지는 효과가 있습니다.

세 번째 갈래는 감산에서 증설로의 전환입니다. 2023년 대규모 감산을 겪은 업계는 2025년과 2026년에 걸쳐 설비 투자를 크게 늘리고 있습니다. SK하이닉스의 2026년 설비 투자는 40조 원 후반대로 알려져 있으며, 청주 M15X의 양산 일정을 앞당기고 용인 1기 팹의 클린룸 가동을 2027년 초로 조기화하는 계획이 진행 중입니다.

네 번째 갈래는 표준품에서 맞춤품으로의 이동입니다. HBM4 세대부터 고객사별 요구에 맞춘 맞춤형 제품이 본격화되면서, 메모리 회사가 고객의 시스템 설계 단계부터 참여하는 구조가 만들어지고 있습니다. 이는 판매 방식과 계약 방식을 함께 바꿉니다.

다섯 번째 갈래는 지정학의 개입입니다. 미국의 대중국 수출 통제, 중국의 자급 정책, 각국의 자국 내 생산 유치 경쟁이 메모리 회사의 투자 결정과 판매 지역 구성에 실질적인 제약을 걸고 있습니다. 삼성전자가 대중국 수출 제한으로 HBM 판로에 영향을 받은 사례가 대표적이며, 이는 경쟁사 간 점유율 변동으로 이어졌습니다.

● 1-11. 공급 제약의 산술, 웨이퍼 잠식이라는 개념

2026년 메모리 시장이 이례적으로 타이트한 이유를 이해하려면 웨이퍼 잠식이라는 개념을 알아야 합니다.

첫째, 용어는 특정 제품 생산이 다른 제품에 쓸 웨이퍼를 잠식하는 현상을 가리킵니다. 둘째, 쉬운 정의로는 같은 밭에서 수익성 높은 작물을 심으면 다른 작물을 심을 땅이 줄어드는 것과 같습니다. 셋째, 산업적으로 중요한 이유는 HBM이 일반 D램보다 훨씬 많은 웨이퍼를 소모하기 때문입니다. HBM은 여러 장의 칩을 쌓아 하나의 제품을 만들고, TSV 공정과 적층 과정에서 손실이 발생하므로, 같은 용량을 만드는 데 일반 D램의 두 배에서 세 배에 이르는 웨이퍼가 필요합니다. 회사가 HBM 생산을 늘리면 일반 D램에 쓸 웨이퍼가 줄어들고, 그 결과 일반 D램 공급이 부족해져 가격이 오릅니다. 넷째, 이 회사와 직무 맥락에서 이 산술은 생산 능력 배분 회의의 핵심 논점입니다. 어느 제품에 웨이퍼를 얼마나 배정할지가 곧 회사 이익을 결정하며, 마케팅 조직이 제시하는 제품별 수익성 분석이 그 판단의 근거가 됩니다.

이 구조 때문에 2026년의 공급 부족은 과거의 부족과 성격이 다릅니다. 과거에는 회사들이 투자를 미뤄서 공급이 부족했지만, 지금은 투자를 늘리고 있음에도 고부가 제품이 생산 능력을 흡수해 일반 제품이 모자라는 형태입니다. 증설이 완료되어도 그 물량이 HBM으로 흘러가면 일반 D램 부족은 쉽게 해소되지 않습니다.

● 1-12. 거시 변수가 작동하는 방식

환율은 두 갈래로 작동합니다. 메모리는 달러로 결제되고 인건비와 일부 경비는 원화로 지출되므로, 원달러 환율이 오르면 원화 환산 매출과 이익이 커집니다. 반대로 장비 구매와 해외 투자는 달러로 이루어지므로 환율 상승이 투자 부담을 키웁니다. 통상 환율 상승은 단기 손익에 우호적이고 장기 투자에는 부담으로 작용합니다.

금리는 두 방향으로 영향을 미칩니다. 하나는 자금 조달 비용입니다. 조 단위 설비 투자를

하는 산업에서 금리는 투자 결정의 문턱을 좌우합니다. 다른 하나는 수요입니다. 금리가 높으면 기업이 정보기술 투자를 미루고 소비자가 기기 교체를 늦춥니다.

정책은 점점 더 큰 변수가 되고 있습니다. 미국은 자국 내 생산 확대를 유도하는 지원과 대중국 수출 통제를 병행하고 있고, 중국은 자급률 제고를 국가 과제로 삼고 있으며, 한국은 반도체 산업 지원을 위한 제도 정비를 논의하고 있습니다. 이 정책들은 회사가 어디에 공장을 짓고 어느 고객에게 무엇을 팔 수 있는지를 결정하는 제약 조건이 됩니다.

기술 사이클은 원가 경쟁력을 좌우합니다. D램은 1a, 1b, 1c 나노 순으로 미세공정이 진화하고 있고, 낸드는 적층 단수 경쟁이 이어지고 있습니다. 다음 세대로 넘어가면 같은 웨이퍼에서 더 많은 칩이 나오므로 비트당 원가가 내려갑니다. 그러나 전환 초기에는 수율이 낮아 오히려 원가가 올라가는 구간이 있고, 이 구간을 얼마나 짧게 통과하느냐가 회사 간 경쟁력 차이를 만듭니다.

● 1-13. 규제와 지정학이 만드는 비대칭

지정학적 제약은 경쟁사마다 다르게 작동하며, 그 비대칭이 시장 점유율을 흔듭니다.

미국의 대중국 수출 통제는 고성능 인공지능 반도체와 관련 부품의 중국 수출을 제한합니다. 이 제한은 중국 고객 비중이 높았던 공급사에 더 큰 타격을 줍니다. 삼성전자의 HBM 출하량 점유율이 2024년 2분기 41%에서 2025년 2분기 17%로 떨어지는 과정에서 대중국 수출 제한이 주요 요인으로 지목된 배경입니다. 반대로 북미 고객 비중이 높았던 SK 하이닉스는 상대적으로 영향을 덜 받았고 반사 이익을 얻었습니다.

중국의 대응은 자급 확대입니다. 창신메모리와 양쯔메모리에 대한 정부 지원이 이어지고 있으며, 이들은 첨단 제품이 아닌 구형 제품 시장을 가격으로 파고들고 있습니다. 이 전략은 단기적으로는 선두 기업에 큰 위협이 되지 않지만, 구형 제품 시장의 가격을 끌어내려 선두 기업이 그 영역에서 이익을 내기 어렵게 만드는 효과가 있습니다.

각국의 자국 생산 유치 경쟁도 변수입니다. 미국은 자국 내 팹 건설을 유도하고 있고, 이는 한국 기업에게 투자 분산과 원가 상승이라는 부담을 안깁니다. 동시에 현지 생산이 관세와 조달 정책에서 유리하게 작용할 여지도 있어, 회사들은 득실을 저울질하며 결정을 내리고 있습니다.

● 1-14. 종합 해석과 시사점

1장을 관통하는 해석은 하나입니다. 메모리 산업은 표준품의 순환 산업에서 인공지능 기반 시설의 핵심 부품 산업으로 이동하는 과도기에 있으며, 그 이동은 완료되지 않았습니다.

이 미완의 이동이 만드는 실무적 결과는 세 가지입니다. 첫째, 같은 회사 안에서 성격이 전혀 다른 두 종류의 사업이 공존합니다. 고객과 함께 설계하고 장기 계약으로 물량을 묶는 HBM 사업과, 분기마다 가격을 흥정하는 일반 메모리 사업이 한 조직 안에 있습니다. 둘째, 생산 능력 배분이 가장 중요한 의사결정이 되었습니다. 무엇을 만들 수 있느냐가 아니라 무엇을 만들지

선택하는 문제가 회사 이익을 좌우합니다. 셋째, 산업의 성장이 완제품 산업의 부담 위에 서 있으므로, 그 부담이 임계점을 넘으면 조정이 옵니다. 가트너가 전망한 PC와 스마트폰 출하 감소는 그 임계점이 가까워지고 있음을 알리는 신호입니다.

이 산업을 이해하려는 사람이라면 세 가지 질문에 스스로 답할 수 있어야 합니다. 이번 상승 국면은 순환인가 구조 변화인가. 고부가 제품 편중은 강점인가 위험인가. 공급 부족을 만드는 진짜 원인은 투자 부족인가 생산 능력 배분인가. 이 질문들에 근거를 갖고 답할 수 있다면 산업의 대부분을 이해한 것입니다.

■ 2장: 주요 기업 비교 및 대상 회사 포지셔닝

● 2-1. 경쟁 구도의 지형도

메모리 산업의 경쟁 구도는 제품군에 따라 완전히 다르게 그려집니다. 하나의 그림으로 뭉뚱그리면 실체를 놓칩니다.

D램 시장은 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 세 회사가 사실상 전부를 차지하는 과점 구조였습니다. 여기에 중국의 창신메모리가 네 번째 사업자로 진입해 2026년 1분기 기준 글로벌 점유율 8% 수준까지 올라왔습니다. 대만의 난야와 원본드는 특수 용도 제품에 특화된 소규모 사업자로 남아 있습니다.

HBM 시장은 D램 시장의 부분집합이지만 구도가 다릅니다. SK하이닉스가 매출 기준 과반을 유지하고 있고, 마이크론이 빠르게 올라섰으며, 삼성전자가 HBM3E 국면의 부진을 HBM4에서 만회하려 하고 있습니다. 카운터포인트 출하량 기준으로 보면 삼성전자는 2024년 2분기 41%에서 2025년 2분기 17%로 내려앉았고, 같은 기간 마이크론은 4%에서 21%로 올라 처음으로 2위에 섰습니다. 중국 업체는 이 영역에 아직 진입하지 못했습니다.

낸드 시장은 참여자가 더 많습니다. 삼성전자, SK하이닉스와 솔리다임, 키옥시아와 샌디스크 연합, 마이크론, 그리고 중국의 양쯔메모리가 경쟁합니다. 양쯔메모리는 2026년 들어 점유율을 13% 수준까지 끌어올린 것으로 집계되고 있습니다. 낸드는 D램보다 참여자가 많고 기술 격차가 상대적으로 작아 가격 경쟁이 더 치열한 영역입니다.

이 구분이 실무에서 중요한 이유는 담당하는 제품군에 따라 상대해야 할 경쟁사와 경쟁의 성격이 달라지기 때문입니다. HBM을 담당하면 삼성전자와 마이크론만 보면 되지만, 일반 D램을 담당하면 창신메모리의 가격 공세를 함께 봐야 하고, 낸드를 담당하면 다섯 개 이상의 경쟁사를 동시에 봐야 합니다.

● 2-2. 삼성전자 메모리사업부

먼저 분석 대상을 정확히 좁혀야 합니다. 삼성전자의 반도체 사업은 디바이스솔루션 부문 아래 메모리사업부, 시스템LSI사업부, 파운드리사업부로 나뉩니다. SK하이닉스와 겨루는 상대는 이

가운데 메모리사업부이며, 파운드리사업부는 오히려 협력과 경쟁이 뒤섞인 별개 영역입니다. 이 구분을 흐리면 삼성전자의 강점과 약점을 잘못 읽게 됩니다.

제품 포트폴리오를 보면 삼성전자 메모리사업부는 D램과 낸드 전 영역을 아우르는 가장 넓은 구성을 갖고 있습니다. 서버, PC, 모바일, 그래픽, 자동차용 제품을 모두 공급하며, 낸드에서도 소비자용부터 기업용까지 전 계층을 담당합니다. 생산 능력 규모에서 세계 최대입니다.

사업 모델의 특징은 수직 통합의 폭입니다. 메모리를 만들면서 로직 설계 역량과 파운드리 생산 능력을 함께 보유하고 있어, HBM처럼 로직과 메모리가 결합되는 제품에서 자체적으로 전 과정을 소화할 수 있습니다. 후공정 패키징 기술도 사내에 갖추고 있습니다. 이론적으로는 메모리와 로직과 패키징을 묶어 하나의 해결책으로 제안할 수 있는 유일한 회사입니다.

강점은 규모와 자본력, 그리고 포트폴리오의 폭입니다. 특정 제품군에서 밀리더라도 다른 제품군에서 만회할 여력이 있고, 대규모 증설을 감당할 재무 체력이 있습니다.

약점은 HBM 국면에서 드러났습니다. HBM3와 HBM3E 세대에서 고객 인증 통과가 늦어지면서 주도권을 내줬고, 여기에 대중국 수출 제한이 겹치며 출하량 점유율이 41%에서 17%로 급락했습니다. 종합 역량이 넓다는 것이 특정 제품에서의 속도를 보장하지는 않는다는 점을 보여 준 사례입니다.

최근 동향으로는 HBM4 세대에서의 반격이 눈에 띕니다. 2026년 상반기 들어 삼성전자는 주요 인공지능 가속기 고객의 HBM4 인증 절차에서 진전을 보였고, 자체 파운드리 공정으로 만든 베이스 다이를 앞세우는 전략을 취하고 있습니다. 이 전략이 성공하면 외부 파운드리에 의존하는 경쟁사 대비 원가와 일정에서 이점을 가질 수 있습니다. 다만 그 성패는 수월에 달려 있으며, 2026년 6월 현재까지 확정적인 결론을 내리기는 어렵습니다.

● 2-3. 마이크론 테크놀로지

마이크론은 미국 아이다호주 보이시에 본사를 둔 메모리 전업 회사입니다. D램과 낸드를 모두 생산하며, 미국 기업 가운데 유일하게 의미 있는 규모의 D램 생산 능력을 보유하고 있습니다.

제품 포트폴리오는 D램에서 서버용, PC용, 모바일용, 그래픽용을 아우르고, 낸드에서는 기업용 저장 장치와 소비자용 제품을 함께 다뤘습니다. 다만 2025년 말 소비자용 메모리 사업에서 물러나 인공지능 데이터센터 고객에 집중하겠다는 방향을 밝혔고, 이후 제품 구성이 기업용으로 재편되고 있습니다.

사업 모델의 특징은 정책 환경의 활용입니다. 미국 정부의 반도체 지원 정책에 따른 보조금과 세액 공제를 받으며 아이다호와 뉴욕에 대규모 생산 기지를 조성하고 있습니다. 미국 내 생산이라는 위치는 미국 정부와 미국 기업 고객에게 조달 안정성이라는 논거를 제공합니다.

강점은 세 가지입니다. 첫째, 정책적 뒷받침입니다. 둘째, 인공지능 가속기 고객과의 관계에서 미국 기업이라는 위치가 주는 이점입니다. 셋째, 최근의 실행 속도입니다. HBM에서 후발

주자였음에도 출하량 점유율을 4%에서 21%로 끌어올린 실행력은 과소평가할 수 없습니다.

약점은 절대 규모입니다. 생산 능력과 매출 규모에서 한국 두 회사에 미치지 못하며, 이는 대규모 수요가 몰릴 때 대응 여력의 차이로 나타납니다. 또한 미국 내 생산 원가가 한국이나 대만보다 높다는 구조적 부담이 있습니다.

최근 동향으로는 인공지능 데이터센터 집중 전략의 심화, 고대역폭 제품군 확대, 대규모 미국 증설의 진행이 이어지고 있습니다. 2026년 상반기 기준 마이크론은 메모리 가격 상승의 수혜를 크게 받으며 실적이 급격히 개선되었습니다.

● 2-4. 키옥시아와 샌디스크

키옥시아는 낸드플래시를 처음 개발한 도시바의 메모리 사업이 분사해 만들어진 일본 기업입니다. 샌디스크는 미국 기업으로, 오랫동안 키옥시아와 일본 윗카이치 및 기타카미 공장을 공동 운영해 왔습니다. 두 회사는 생산 시설을 공유하되 판매는 각자 하는 독특한 구조를 유지하고 있으며, 2026년 초 윗카이치 합작 관계를 2030년대까지 연장하는 합의가 이루어졌습니다.

제품 포트폴리오는 낸드에 집중되어 있습니다. D램과 HBM에는 참여하지 않습니다. 적층 기술에서 독자 계보를 갖고 있으며, 기업용 저장 장치와 소비자용 제품을 모두 다룹니다.

사업 모델의 특징은 전문화입니다. 하나의 제품군에 자원을 집중해 기술 깊이를 확보하는 전략입니다. 생산 시설 공동 운영은 대규모 투자 부담을 나눠 지는 효과가 있습니다.

강점은 낸드 기술의 깊이와 오랜 고객 관계입니다. 인공지능 추론 확산으로 대용량 저장 장치 수요가 늘면서 이들의 가치가 재평가되고 있으며, 2026년 상반기 들어 두 회사의 기업 가치는 크게 상승했습니다.

약점은 명확합니다. D램과 HBM이 없다는 것입니다. 메모리 산업의 이익 대부분이 HBM과 서버용 D램에서 나오는 국면에서, 이 영역에 참여하지 못하는 것은 성장의 상한을 스스로 제한하는 결과가 됩니다. 또한 낸드 단일 사업이므로 낸드 가격 하락 국면에서 완충 장치가 없습니다.

최근 동향으로는 고대역폭 플래시 기술의 표준화 논의가 주목됩니다. 낸드를 HBM과 유사한 방식으로 적층해 대역폭을 크게 높이는 개념으로, SK하이닉스와 샌디스크가 함께 표준화를 추진하고 있습니다. 성사되면 낸드가 저장 영역을 넘어 인공지능 연산의 데이터 공급 경로에 참여하게 되며, 낸드 사업의 위상이 달라질 수 있습니다.

● 2-5. 창신메모리

창신메모리는 중국 안후이성 허페이에 기반을 둔 중국 최대 D램 기업입니다. 2016년 설립 이후 정부와 지방 정부의 대규모 지원을 받아 성장했습니다.

제품 포트폴리오는 구형 규격 중심입니다. 서버용 고성능 제품보다는 소비자 기기와 산업용에

쓰이는 제품에 집중해 왔고, 최근 모바일용 저전력 제품과 그래픽용 제품으로 영역을 넓히고 있습니다.

사업 모델의 특징은 내수 우선과 가격 공세입니다. 중국 정부의 자금 정책에 따라 중국 내 완제품 제조사가 국산 부품을 채택하도록 유도되고 있으며, 이 보호된 수요를 기반으로 규모를 키우는 전략입니다.

강점은 정책 지원, 거대한 내수 시장, 그리고 낮은 가격입니다. 2025년 매출은 전년 대비 130% 증가한 약 80억 달러로 추정되며, 2026년 1분기 기준 글로벌 D램 점유율은 8% 수준까지 올라왔습니다. 2026년 상반기에는 중국 증권거래소 상장을 추진하며 대규모 자금 조달에 나섰습니다.

약점은 기술 격차와 장비 제약입니다. 선두권 대비 두세 세대 뒤진 공정에 머물러 있고, 미국의 수출 통제로 최첨단 노광 장비 확보가 어렵습니다. HBM과 같은 고부가 제품에는 아직 진입하지 못했습니다.

최근 동향에서 주목할 지점은 두 가지입니다. 하나는 구형 제품 시장에서의 존재감 확대이며, 이는 선두 기업이 구형 제품에서 이익을 내기 어렵게 만듭니다. 다른 하나는 중국 내 노광 장비 국산화 시도에 관한 보도들이며, 이런 소식이 나올 때마다 한국 반도체 관련 주가가 민감하게 반응하고 있습니다. 실제 기술 수준에 관해서는 확인되지 않은 부분이 많으므로, 보도만으로 단정하기보다 검증된 양산 실적을 기준으로 판단하는 편이 합리적입니다.

● 2-6. 양쯔메모리와 그 밖의 참여자

양쯔메모리는 중국 후베이성 우한에 기반을 둔 중국 최대 낸드 기업입니다. 독자적인 적층 구조 기술을 개발했다고 알려져 있으며, 2026년 들어 글로벌 낸드 점유율을 13% 수준까지 끌어올린 것으로 집계됩니다. 낸드는 D램보다 기술 진입 장벽이 상대적으로 낮아 중국 기업의 추격이 더 빠르게 진행되고 있습니다.

대만의 난야테크놀로지와 윈본드는 특수 용도 D램에 특화된 소규모 사업자입니다. 산업용 기기, 통신 장비, 자동차 등에 쓰이는 소용량 제품을 다루며, 대형 3사가 관심을 두지 않는 영역에서 자리를 지키고 있습니다. 이들의 존재는 시장 전체 구도에 큰 영향을 주지 않지만, 특정 응용 분야에서는 무시할 수 없는 경쟁자입니다.

인텔은 메모리 사업에서 이미 물러났습니다. 낸드 사업은 SK하이닉스에 매각되어 솔리다임이 되었고, 옵테인이라 불리던 신개념 메모리 사업도 정리했습니다. 이 사례는 메모리가 자본과 규모의 산업이며, 세계 최대 반도체 기업조차 규모의 열위를 극복하지 못하면 철수할 수밖에 없다는 점을 보여 줍니다.

● 2-7. SK하이닉스의 포지셔닝 규정

이제 경쟁사와 견주어 SK하이닉스의 위치를 규정해 보겠습니다.

고객 유형으로 보면 SK하이닉스는 전형적인 기업 간 거래 회사입니다. 최종 소비자에게 파는 제품이 거의 없고, 인공지능 가속기 설계사, 클라우드 사업자, 서버 제조사, 스마트폰 제조사 같은 기업 고객에게 판매합니다. 이 성격은 판매 방식에 결정적 영향을 미칩니다. 소수의 대형 고객이 매출 대부분을 차지하므로 개별 고객과의 관계가 회사 실적을 좌우하고, 광고나 유통망보다 기술 신뢰와 공급 안정성이 판매의 핵심 요소가 됩니다.

가격대와 제품 구성으로 보면 SK하이닉스는 프리미엄 편중형입니다. 삼성전자가 전 계층을 폭넓게 다루는 종합형이라면, SK하이닉스는 고부가 영역에 자원을 집중하는 선택을 했습니다. 이 선택은 이익률에서는 유리하지만 특정 수요처 의존도가 높아진다는 위험을 함께 안습니다.

기술 전략으로 보면 개방형 협업 모델입니다. 삼성전자가 자체 파운드리로 베이스 다이를 소화하는 자급형 접근을 택한 데 비해, SK하이닉스는 검증된 외부 파운드리를 활용하는 접근을 택했습니다. 이는 초기 위험을 줄이는 대신 외부 의존이라는 부담을 지는 선택입니다.

포트폴리오 범위로 보면 D램 중심의 균형형입니다. 키옥시아처럼 낸드 단일 사업도 아니고 삼성전자처럼 시스템반도체까지 아우르는 종합형도 아닌, 메모리 전업이면서 D램과 낸드를 모두 보유한 위치입니다.

이 네 가지를 종합하면 SK하이닉스는 인공지능 인프라 수요에 특화된 프리미엄 메모리 전업 기업이라 규정할 수 있습니다. 이 위치는 인공지능 수요가 이어지는 한 매우 유리하고, 그 수요가 흔들리면 가장 크게 흔들리는 위치이기도 합니다.

● 2-8. 최근 6개월 회사별 주요 사안

2026년 상반기를 기준으로 회사별 흐름을 정리하겠습니다.

SK하이닉스는 1분기 사상 최대 실적을 발표하며 영업이익률 72%를 기록했고, 2026년 생산 물량의 상당 부분을 이미 계약으로 확정된 상태로 알려져 있습니다. 핵심 고객을 포함한 다수 고객과 장기공급계약 협상을 진행했고, 설비 투자를 40조 원 후반대로 확대하며 청주와 용인의 생산 능력 조기 확보를 추진하고 있습니다. 미국 예탁증서 상장을 통한 해외 자금 조달도 추진되었습니다.

삼성전자 메모리사업부는 HBM4 인증에서 진전을 보이며 반격 국면에 들어섰습니다. 자체 파운드리 공정을 활용한 베이스 다이 전략이 성과를 낼지가 관건이며, 동시에 일반 D램 가격 급등의 수혜를 크게 받고 있습니다.

마이크론은 소비자 사업 정리와 데이터센터 집중 전략을 이어 가고 있으며, 미국 내 대규모 증설을 진행 중입니다. HBM 점유율 확대가 지속되고 있습니다.

키옥시아와 샌디스크는 낸드 가격 급등의 수혜를 받고 있으며, 고대역폭 플래시 표준화 논의를 진전시키고 있습니다.

창신메모리는 증권거래소 상장을 추진하며 자금 조달에 나섰고, 구형 D램 시장에서 존재감을 키우고 있습니다.

● 2-9. 베어 케이스, 이 시장과 이 회사에 관한 비관적 시각

균형 잡힌 이해를 위해서는 비관론의 논리를 정확히 파악해야 합니다. 네 가지 갈래로 정리하겠습니다.

첫째, 공급 과잉 위험입니다. 세 개 선두 기업이 모두 설비 투자를 대폭 늘리고 있고, 중국 기업까지 증설에 가세하고 있습니다. 반도체 공장은 착공에서 양산까지 3년 안팎이 걸리므로, 2026년에 시작된 투자는 2028년에서 2029년 사이에 물량으로 나타납니다. 만약 그 시점에 인공지능 투자 속도가 둔화된다면 공급과 수요가 어긋나며 급격한 조정이 올 수 있습니다. 과거 사이클에서 반복적으로 관찰된 흐름이며, 이번이라고 예외라는 보장은 없습니다.

둘째, 중국 굴기입니다. 창신메모리의 자금 조달 성공과 중국의 장비 국산화 시도는 구조적 위협의 신호입니다. 일부 시장 전문가들은 중국이 2030년까지 D램 시장의 상당 부분을 차지할 수 있다고 전망합니다. 중국 기업이 첨단 영역에 진입하지 못하더라도, 구형 영역의 가격을 끌어내려 선두 기업의 이익 기반을 잠식하는 효과는 이미 나타나고 있습니다.

셋째, 인공지능 투자의 지속 가능성 문제입니다. 대형 기술 기업들이 데이터센터에 쏟아붓고 있는 자금이 실제 수익으로 돌아오지 않는다면 투자 규모는 조정될 수밖에 없습니다. 일부 대형 기업의 잉여현금흐름이 대규모 데이터센터 투자로 인해 흑자에서 적자로 돌아선 사례들이 이미 관찰되고 있습니다. 약속된 투자 계획과 실제 집행 사이에 간극이 생기기 시작하면 메모리 수요 전망은 빠르게 하향 조정될 수 있습니다.

넷째, HBM 경쟁 심화입니다. HBM3E 세대에서 SK하이닉스가 누린 사실상의 독점적 위치는 HBM4 세대에서 유지되기 어려울 수 있습니다. 2026년 상반기 기준으로 주요 인공지능 가속기 고객이 세 회사 모두를 인증 절차에 올려놓은 것으로 알려져 있으며, 공급선이 다변화되면 가격 협상력이 약해집니다. 독점적 위치에서 나오던 이익률이 정상화되는 과정은 실적에 큰 폭의 조정을 가져올 수 있습니다.

다섯째, 완제품 산업의 반발입니다. 메모리 가격 급등은 PC와 스마트폰 제조사의 원가를 압박하고 있고, 이들은 탑재 용량을 줄이거나 출하를 축소하는 방식으로 대응하고 있습니다. 이 대응이 누적되면 메모리 수요 자체가 위축됩니다. 단기 이익 극대화가 중기 수요 기반을 갉아먹는 구조입니다.

● 2-10. 종합 해석과 시사점

2장의 해석은 다음과 같이 정리됩니다.

SK하이닉스의 현재 위치는 실력과 환경이 함께 만든 결과입니다. HBM 선행 개발이라는 실력이 있었고, 경쟁사의 인증 지연과 지정학적 제약이라는 환경이 겹쳤습니다. 이 가운데

실력은 유지될 수 있지만 환경은 바뀝니다. 경쟁사의 인 증은 결국 통과되고 있고, 지정학적 조건도 고정된 것이 아닙니다.

따라서 이 회사의 중기 과제는 환경 요인이 사라진 뒤에도 유지될 수 있는 우위를 만드는 일입니다. 그 후보는 세 가지입니다. 하나는 고객의 설계 단계에 참여해 대체하기 어려운 위치를 만드는 것이고, 둘은 장기 계약으로 물량과 가격을 미리 묶어 두는 것이며, 셋은 HBM 외의 제품군에서도 이익을 낼 수 있는 구조를 만드는 것입니다. Full Stack AI Memory Creator라는 표현은 이 세 가지 과제를 함께 담은 선언으로 읽을 수 있습니다.

경쟁사 분석에서 놓치지 말아야 할 지점은 각 회사의 약점이 서로 다른 성격이라는 것입니다. 삼성전자의 약점은 실행 속도이고, 마이크론의 약점은 규모이며, 키옥시아의 약점은 포트폴리오 범위이고, 창신메모리의 약점은 기술 수준입니다. 이 가운데 실행 속도는 가장 빠르게 개선될 수 있는 약점입니다. 삼성전자가 HBM4에서 속도를 회복한다면 경쟁 구도는 빠르게 재편될 수 있습니다.

■ 3장: 대상 회사 심층 분석

● 3-1. 법인 연혁과 시점 구분

SK하이닉스의 역사를 다룰 때는 법인의 변화 시점을 정확히 구분해야 합니다. 과거 법인의 실적이나 사건을 현재 법인의 것으로 뭉뚱그리면 사실관계가 어긋납니다.

법인의 출발점은 1949년 설립된 국도건설입니다. 반도체와 무관한 회사였고, 이후 여러 변화를 거쳤습니다. 반도체 사업의 실질적 시작은 1983년입니다. 현대그룹이 이 법인을 기반으로 현대전자산업을 세우고 반도체 사업에 진출했습니다. 1980년대와 1990년대에 걸쳐 D램 생산 능력을 키웠고, 한국이 메모리 강국으로 올라서는 과정에 참여했습니다.

1999년은 중요한 전환점입니다. 외환위기 이후 진행된 산업 구조 조정 과정에서 현대전자가 LG반도체를 흡수 합병했습니다. 이로써 국내 D램 사업자는 삼성전자와 현대전자 두 곳으로 정리되었습니다. 그러나 합병 과정에서 떠안은 부채와 이어진 D램 가격 폭락이 회사를 벼랑으로 몰았습니다.

2001년에는 회사가 채권단 관리 체제에 들어가며 사명을 하이닉스반도체로 바꿨습니다. 이후 약 10년 동안 뚜렷한 주인 없이 채권단 관리 아래 구조 조정을 이어 갔습니다. 이 기간 동안 회사는 투자 여력이 부족한 상태에서도 기술 개발을 이어 갔고, 여러 차례 매각 시도가 무산되는 과정을 겪었습니다.

2012년 2월 SK텔레콤이 약 3조 3,750억 원에 지분을 인수하며 SK그룹에 편입되었고, 같은 해 3월 사명이 SK하이닉스로 바뀌었습니다. 인수 당시 그룹 안팎에서는 위험한 결정이라는 평가가 적지 않았습니다. 메모리는 대규모 투자가 지속적으로 필요한 사업이고, 당시 회사는 재무 여력이 약했기 때문입니다. 그러나 인수 이후 안정적인 투자 재원이

공급되면서 회사는 기술 격차를 좁혀 나갔습니다.

2020년에는 인텔의 낸드 사업 인수를 발표했고, 이후 단계적 절차를 거쳐 솔리다임이라는 자회사가 만들어졌습니다. 이 인수로 회사는 기업용 저장 장치 영역의 고객 기반과 제품 계보를 확보했습니다.

2022년부터 2026년까지의 흐름은 HBM으로 요약됩니다. HBM3의 선제적 공급, HBM3E의 주도권 확보, HBM4 준비가 이어졌고, 2025년 1분기 D램 매출 1위 등극과 2026년 상반기의 사상 최대 실적으로 이어졌습니다.

이 연혁에서 눈여겨볼 지점은 조직의 연속성입니다. 2026년 현재 회사의 주요 경영진 상당수가 현대전자 시기에 입사한 인물들입니다. 부도 위기와 채권단 관리를 거친 경험이 조직 안에 남아 있으며, 회사는 이를 원팀 정신이라는 표현으로 설명해 왔습니다.

● 3-2. 사업 구조와 매출 구성

SK하이닉스는 D램과 낸드의 매출을 세분해 공시하지 않습니다. 따라서 정확한 비중은 외부에서 확인하기 어렵고, 시장 추정에 의존해야 합니다. 이 점은 분석의 한계로 솔직히 밝혀 두겠습니다.

시장에서 통용되는 추정에 따르면 D램이 전체 매출의 대략 3분의 2, 낸드가 3분의 1 수준입니다. 이익 기준으로 보면 D램의 비중이 훨씬 높고, 그중에서도 HBM의 기여가 압도적입니다. 앞서 인용한 2025년 1분기 기준 수치를 다시 정리하면, HBM은 D램 출하량의 14%, D램 매출의 44%, D램 영업이익의 54%를 담당했습니다. 세 숫자의 격차가 이 사업의 성격을 압축해 보여 줍니다. 물량은 적는데 매출 기여는 세 배 이상이고, 이익 기여는 그보다 더 큼니다.

응용처별로 보면 데이터센터 관련 수요가 사업의 중심에 있습니다. HBM과 서버용 D램을 합친 매출 비중이 2025년 1분기에 77%까지 올라갔다는 집계는 이 회사가 사실상 인공지능 인프라 부품 회사로 재편되었음을 보여 줍니다. 모바일과 PC 관련 매출은 절대 금액으로는 유지되고 있으나 상대 비중은 계속 낮아지고 있습니다.

낸드 사업은 SK하이닉스 본사와 자회사 솔리다임으로 나뉘어 운영됩니다. 본사는 모바일용과 소비자용, 일부 기업용을 담당하고, 솔리다임은 기업용 저장 장치에 특화되어 있습니다. 두 조직이 제품 계보와 고객 기반을 나눠 갖고 있으며, 최근에는 두 조직의 제품군을 함께 묶어 제안하는 방식이 늘고 있습니다.

● 3-3. 조직 구조 안에서 이 직무의 위치

이 보고서가 다루는 직무를 정확히 이해하려면 회사 조직 안에서 이 일이 어디에 놓이는지 파악해야 합니다.

메모리 회사의 조직은 크게 개발, 제조, 사업으로 나뉩니다. 개발 조직은 D램과 낸드의 설계와

공정을 담당하고, 제조 조직은 실제 생산과 수율 관리를 맡으며, 사업 조직은 제품 기획과 판매를 담당합니다. 이 직무는 세 번째, 사업 조직에 속합니다.

사업 조직은 다시 제품군별로 나뉩니다. 인공지능 인프라 관련 제품을 담당하는 조직, D램 마케팅 조직, 낸드 마케팅 조직, 그리고 지역별 영업 조직 등으로 구성되는 것이 일반적입니다. 근무지가 이천과 서울로 명시된 것도 이 구조와 관련이 있습니다. 이천은 생산 기지이자 개발 조직이 있는 곳이므로 제품 기획과 사업화 업무가 개발 및 제조 조직과 가까이에서 이루어지고, 서울은 고객 접점과 대외 활동이 이루어지는 곳입니다.

여기서 흔한 오해를 짚어 두겠습니다. 이 직무는 개발이나 공정 관리와 명확히 구분됩니다. 반도체 회사의 채용에서 기술 직군이라 하면 통상 소자 개발, 공정 개발, 양산 기술, 패키징, 품질 등을 가리키며, 이들은 제품을 만드는 일을 합니다. 반면 이 직무는 무엇을 만들지 정하고 만들어진 것을 파는 일을 합니다. 반도체 지식이 필요하지만 그 지식을 쓰는 방식이 다릅니다. 개발 직군은 지식을 써서 문제를 해결하고, 이 직무는 지식을 써서 고객과 사내 조직 사이의 언어를 옮기고 판단의 근거를 만듭니다.

또 하나 구분할 지점은 솔리다임과의 관계입니다. 솔리다임은 별도 법인이며 자체 영업 조직을 갖고 있습니다. 본사 마케팅 조직과 솔리다임 조직은 협업하지만 같은 조직은 아닙니다. 채용 공고가 SK하이닉스 본사 기준이라면 담당하게 될 제품군과 고객군도 본사 기준으로 이해해야 합니다.

● 3-4. 2026년 상반기 실적과 재무 상태

2026년 6월 현재 확인 가능한 가장 최근의 확정 실적은 1분기입니다. 매출 52조 5,763억 원, 영업이익 37조 6,103억 원, 영업이익률 72%입니다.

이 수치의 의미를 짚어 보겠습니다. 제조업에서 영업이익률 72%는 통상적으로 관찰되지 않습니다. 소프트웨어나 지식재산권 사업에서나 볼 수 있는 수준입니다. 이런 수치가 나온 이유는 세 가지가 겹쳤기 때문입니다. 첫째, 판매 가격이 급등했습니다. 둘째, 원가는 상대적으로 천천히 움직였습니다. 이미 지어진 공장과 이미 도입된 장비로 생산하므로 고정비가 크게 늘지 않았습니다. 셋째, 고부가 제품 비중이 높아지며 제품 구성 효과가 더해졌습니다.

이 구조는 반대 방향으로도 똑같이 작동합니다. 가격이 떨어지면 매출이 줄고 고정비는 그대로 남으므로 이익이 급격히 사라집니다. 2023년의 대규모 적자가 그 사례입니다. 따라서 현재의 높은 이익률을 항구적인 것으로 해석하는 것은 위험하며, 회사 내부에서도 이 점을 전제로 투자 계획을 짜고 있습니다.

전년 동기와 비교하면 변화의 폭이 더 분명해집니다. 2025년 2분기 매출 22조 2,320억 원, 영업이익 9조 2,129억 원과 견주면 세 분기 만에 매출이 두 배 이상, 영업이익이 네 배 이상으로 늘었습니다. 이 정도의 변화는 회사의 의사결정 방식 자체를 바꿉니다. 자금 여력이 커지면서 투자 결정의 폭이 넓어지고, 동시에 그 자금을 어디에 쓸 것인지에 관한 판단의 무게가 커집니다.

재무 구조 측면에서는 차입금 부담이 크게 줄고 현금 여력이 확대되는 흐름이 이어지고 있습니다. 과거 채권단 관리 시기의 취약한 재무 구조와 비교하면 완전히 다른 상태이며, 이는 대규모 투자를 감당할 체력을 확보했다는 뜻입니다.

● 3-5. 중장기 전략, Full Stack AI Memory Creator

회사의 중장기 방향을 가장 압축적으로 보여 주는 것은 박노정 최고경영자가 2025년 11월 SK AI 서밋에서 밝힌 표현입니다. 그는 회사가 그동안 고객이 원하는 제품을 적기에 공급하는 역할을 해 왔다면, 앞으로는 고객이 가진 문제를 함께 해결하며 생태계와 협업해 고객이 기대하는 것 이상의 가치를 제공할겠다는 취지로 말했습니다. 표현이 공급자에서 창조자로 바뀐 것입니다.

이 표현이 담고 있는 실질적 함의는 세 가지입니다.

첫째, 제품 정의의 주체가 바뀝니다. 표준품 시대에는 국제 표준 기구가 규격을 정하고 회사는 그 규격에 맞는 제품을 잘 만들면 되었습니다. 맞춤형 시대에는 고객의 시스템 요구에서 출발해 제품 규격을 함께 정합니다. 이 변화는 상품기획 조직의 업무 범위를 크게 넓힙니다.

둘째, 협업의 범위가 넓어집니다. 로직 공정을 다루는 파운드리, 저장 장치 표준을 만드는 업계 단체, 인공지능 소프트웨어 생태계와의 협업이 필요해집니다. 회사 혼자 완결하는 구조가 아니라 여러 참여자를 엮는 구조입니다.

셋째, 제품군이 넓어집니다. 회사는 맞춤형 HBM에 더해 인공지능 연산에 최적화된 D램과 낸드 제품군을 새로 제시하고 있습니다. 저장 장치에 연산 기능을 결합하거나, 대역폭을 크게 높인 플래시를 만들거나, 메모리를 연결해 용량을 확장하는 방식 등이 검토되고 있습니다.

이 전략을 뒷받침하는 협업 관계로는 인공지능 가속기 설계사와의 제품 공동 개발, 파운드리 기업과의 베이스 다이 협업, 저장 장치 기업과의 표준화 협력, 대형 인공지능 기업과의 장기 공급 논의 등이 진행되고 있습니다.

● 3-6. 제품군별 전략의 세부

HBM 제품군에서는 세대 전환의 속도와 맞춤화 대응이 핵심입니다. HBM4는 베이스 다이의 복잡도가 높아져 파운드리 협업이 필수가 되었고, 고객별 요구 사항이 갈라지면서 하나의 제품으로 여러 고객을 대응하기 어려워졌습니다. 회사는 검증된 외부 로직 공정을 활용해 초기 위험을 줄이는 방식을 택했습니다.

서버용 D램 제품군에서는 용량과 신뢰성이 관건입니다. 인공지능 서버는 일반 서버보다 훨씬 많은 메모리를 요구하며, 이 수요가 일반 서버용 D램 시장까지 끌어올리고 있습니다. 회사는 고용량 모듈 제품군을 확대하고 있습니다.

모바일용 저전력 D램 제품군에서는 인공지능 기능이 기기 안에서 작동하는 흐름이 새로운 수요를 만들고 있습니다. 기기에서 인공지능을 구동하려면 더 많은 메모리가 필요하고, 전력

소모를 줄이는 기술이 중요해집니다. 또한 저전력 D램을 서버에 쓰려는 시도가 나타나면서 이 제품군의 응용 범위가 넓어지고 있습니다.

기업용 저장 장치 제품군에서는 고용량과 저전력이 경쟁 요소입니다. 인공지능 추론이 확산되면서 데이터센터가 저장해야 할 데이터가 급증했고, 전력 예산이 제한된 상황에서 같은 전력으로 더 많은 데이터를 다루는 제품이 선호됩니다. 회사는 고단 적층과 다중 비트 저장 기술을 결합한 제품으로 대응하고 있으며, 솔리다임의 제품군과 함께 제안하는 방식을 쓰고 있습니다.

차세대 제품군으로는 메모리 확장 기술과 연산 결합 메모리가 준비되고 있습니다. 메모리 확장 기술은 여러 메모리를 하나의 시스템에 연결해 용량을 크게 늘리는 접근이며, 연산 결합 메모리는 메모리 내부에 간단한 연산 기능을 넣어 데이터 이동을 줄이는 접근입니다. 두 기술 모두 아직 시장이 본격적으로 열리지 않았으나, 상품기획 조직은 이런 기술의 상용화 시점을 예측하고 제품 계획에 반영해야 합니다.

● 3-7. 생산 능력과 투자 계획

2026년 회사의 설비 투자는 40조 원 후반대로 알려져 있습니다. 주요 계획은 다음과 같습니다.

청주 M15X의 양산 일정을 앞당기고 있습니다. 기존 계획보다 빠르게 가동해 늘어난 수요에 대응하려는 것입니다. 용인 반도체 클러스터의 1기 팹은 2027년 초 클린룸 가동을 목표로 준비되고 있으며, 이는 당초 일정보다 앞당겨진 것입니다. 용인 클러스터의 후속 팹과 청주의 추가 팹에 관한 투자 검토도 진행 중입니다.

여기서 회사가 강조하는 원칙이 있습니다. 팹 건물 자체는 계획대로 짓되, 그 안에 클린룸을 만들고 장비를 들이는 일은 수요 가시성에 맞춰 단계적으로 진행한다는 것입니다. 이 원칙은 사이클 위험을 관리하는 장치입니다. 건물은 미리 지어 두면 수요가 왔을 때 빠르게 대응할 수 있고, 장비 투입은 미루면 자금 부담을 줄일 수 있습니다.

생산 능력 확대의 제약 요인도 짚어야 합니다. 첫째, 장비 조달 기간입니다. 노광 장비를 비롯한 핵심 장비는 주문에서 인도까지 상당한 시간이 걸리고, 전 세계 회사들이 동시에 주문하면 대기 시간이 더 길어집니다. 둘째, 전력과 용수입니다. 반도체 공장은 막대한 전력과 초순수를 소모하며, 이를 공급할 기반 시설이 준비되지 않으면 공장을 지어도 가동할 수 없습니다. 셋째, 인력입니다. 새 공장을 운영할 숙련 인력을 확보하는 데 시간이 걸립니다.

이 제약들 때문에 증설은 회사가 원하는 속도로 진행되지 않습니다. 이것이 2026년의 공급 부족이 쉽게 풀리지 않는 이유이며, 동시에 2028년 이후 공급이 한꺼번에 쏟아질 위험의 근거이기도 합니다.

● 3-8. 파트너십 생태계

SK하이닉스의 전략에서 파트너십이 차지하는 비중은 과거보다 훨씬 커졌습니다.

파운드리 협업은 HBM4 세대의 핵심입니다. 베이스 다이를 로직 전문 공정으로 만들어 성능과 수율을 확보하는 접근이며, 이는 메모리 회사가 자체 공정만으로 대응하기 어려운 영역에서 외부 역량을 끌어 쓰는 선택입니다. 이 협업은 이점과 위험을 함께 안습니다. 이점은 검증된 공정을 쓰므로 초기 위험이 작다는 것이고, 위험은 공급 일정과 원가를 스스로 통제하기 어렵다는 것입니다.

인공지능 가속기 설계사와의 관계는 납품 관계를 넘어섰습니다. 제품 개발 초기 단계부터 요구 사항을 공유하고, 제조 공정 혁신을 위한 협업까지 진행되고 있습니다. 이런 관계는 진입 장벽으로 작동합니다. 새로운 공급사가 들어오려면 기술만이 아니라 축적된 협업 경험까지 따라잡아야 하기 때문입니다.

저장 장치 영역에서는 업계 표준화 협력이 진행되고 있습니다. 낸드를 적층해 대역폭을 크게 높이는 기술의 표준을 함께 만드는 작업이며, 표준이 만들어지면 시장이 열리고 표준을 주도한 회사가 유리한 위치를 갖게 됩니다.

자회사 솔리다임과의 관계는 내부 협업이면서 동시에 통합 과제이기도 합니다. 서로 다른 기업 문화와 제품 계보를 가진 조직을 하나의 전략 아래 묶는 일은 시간이 걸리는 작업이며, 2026년 현재도 진행 중인 과제로 볼 수 있습니다.

● 3-9. 차별화 요인의 해부

SK하이닉스의 경쟁 우위를 네 갈래로 나누어 살펴보겠습니다.

첫째, 기술 선형성입니다. HBM 영역에서 세대마다 먼저 개발하고 먼저 공급한 경험이 쌓여 있습니다. 이 경험은 문서화된 기술만이 아니라 조직의 학습으로 남습니다. 어떤 조건에서 문제가 생기는지, 고객이 어떤 항목을 까다롭게 보는지, 어떤 순서로 검증을 진행해야 시간이 절약되는지에 관한 지식은 뒤따르는 회사가 빠르게 확보하기 어렵습니다.

둘째, 고객 신뢰입니다. 인공지능 가속기 설계사는 메모리 공급이 흔들리면 자사 제품 출하가 멈춥니다. 따라서 검증된 공급사를 쉽게 바꾸지 않습니다. 이 관성은 SK하이닉스에게 유리하게 작동하지만, 동시에 한 번 신뢰를 잃으면 회복이 어렵다는 뜻이기도 합니다.

셋째, 제품 포트폴리오의 폭입니다. 인공지능 인프라를 구성하는 부품 가운데 고대역폭 메모리, 서버용 D램, 기업용 저장 장치를 모두 공급할 수 있습니다. 고객이 여러 부품을 한 곳에서 조달하려 할 때 유리한 위치입니다.

넷째, 위기 대응 경험입니다. 부도 위기와 채권단 관리를 거친 조직 경험은 호황기의 의사결정에도 영향을 미칩니다. 회사가 증설을 추진하면서도 단계적 투자 원칙을 강조하는 배경에는 이 경험이 있다고 볼 수 있습니다.

한편 차별화 요인으로 자주 언급되지만 실제로는 취약한 부분도 있습니다. 원가 경쟁력은 그 하나입니다. 회사는 고부가 제품에서 이익을 내고 있으나, 범용 제품의 원가 경쟁력만 놓고 보면 경쟁사 대비 뚜렷한 우위를 주장하기 어렵습니다. 이 점은 시장이 정상화될 때 드러날 수 있는

약점입니다.

● 3-10. 리스크 요인

리스크를 무엇이, 왜, 얼마나 일어날 법한지, 얼마나 크게 영향을 미치는지로 나누어 서술하겠습니다.

첫 번째는 수요 집중 위험입니다. 무엇이 문제인가 하면, 매출과 이익이 인공지능 데이터센터라는 하나의 수요처에 크게 의존하고 있다는 점입니다. 왜 문제가 되는가 하면, 이 수요는 소수의 대형 기업이 결정하는 투자에 좌우되기 때문입니다. 열 개가 안 되는 기업의 투자 계획이 바뀌면 시장 전체가 흔들립니다. 발생 가능성은 중기적으로 상당합니다. 인공지능 투자가 영원히 같은 속도로 늘어날 수는 없기 때문입니다. 영향도는 매우 큼니다. HBM과 서버용 D램이 이익 대부분을 만드는 구조에서 이 수요가 흔들리면 대체할 이익원이 없습니다.

두 번째는 경쟁 심화 위험입니다. 무엇이 문제인가 하면, HBM4 세대에서 경쟁사들이 인증을 통과하며 공급선이 다변화되고 있다는 점입니다. 왜 문제가 되는가 하면, 사실상 단독 공급에 가까운 위치에서 나오던 가격 협상력이 약해지기 때문입니다. 고객은 복수 공급사를 확보하면 가격 인하를 요구할 여지가 생깁니다. 발생 가능성은 이미 현실화가 진행 중입니다. 영향도는 큼니다. 점유율 하락과 가격 하락이 함께 오면 이익률 조정 폭이 커집니다.

세 번째는 사이클 반전 위험입니다. 무엇이 문제인가 하면, 업계 전체가 동시에 증설하고 있고 그 물량이 2028년 전후에 나타난다는 점입니다. 왜 문제가 되는가 하면, 공급이 계단식으로 늘어나는 반면 수요는 연속적으로 변하기 때문에 어긋남이 생기기 쉽습니다. 발생 가능성은 과거 사이클의 반복성을 감안하면 낮지 않습니다. 영향도는 매우 큼니다. 고정비 부담이 큰 산업에서 가격 하락은 이익을 빠르게 소멸시킵니다.

네 번째는 외부 공정 의존 위험입니다. 무엇이 문제인가 하면, HBM4의 핵심 부품을 외부 파운드리에 맡기고 있다는 점입니다. 왜 문제가 되는가 하면, 그 파운드리의 생산 능력 배분과 가격 정책에 회사의 제품 일정이 좌우되기 때문입니다. 해당 파운드리는 인공지능 가속기 자체도 생산하고 있어 생산 능력 경쟁이 벌어질 여지가 있습니다. 발생 가능성은 중간 정도입니다. 영향도는 중간에서 큼 사이입니다. 일정 지연이 발생하면 인증 일정 전체가 밀립니다.

다섯 번째는 지정학 위험입니다. 무엇이 문제인가 하면, 수출 통제와 관세 정책이 판매 가능 지역과 원가에 영향을 미친다는 점입니다. 왜 문제가 되는가 하면, 이 변수는 회사가 통제할 수 없고 예고 없이 바뀌기 때문입니다. 발생 가능성은 상시적입니다. 영향도는 중간입니다. 다만 특정 사건이 크게 터지면 영향이 급격히 커질 수 있습니다.

여섯 번째는 인력 위험입니다. 무엇이 문제인가 하면, 급격한 증설에 필요한 숙련 인력을 확보하기 어렵다는 점입니다. 왜 문제가 되는가 하면, 반도체 공정 인력은 양성에 오랜 시간이 걸리고 국내 인력 풀이 제한적이며 경쟁사와 해외 기업의 영입 경쟁이 치열하기 때문입니다.

발생 가능성은 이미 진행 중입니다. 영향도는 중장기적으로 큼니다. 공장을 지어도 운영할 사람이 없으면 생산 능력이 실현되지 않습니다.

일곱 번째는 완제품 수요 위축 위험입니다. 무엇이 문제인가 하면, 메모리 가격 급등이 PC와 스마트폰 출하 감소로 이어지고 있다는 점입니다. 왜 문제가 되는가 하면, 이들 시장은 여전히 메모리 물량의 상당 부분을 흡수하는 곳이고, 이 시장이 위축되면 인공지능 수요가 둔화될 때 완충 장치가 사라지기 때문입니다. 발생 가능성은 이미 나타나고 있습니다. 영향도는 중간입니다.

● 3-11. 전략 옵션, 세 가지 시나리오

회사의 전략 담당자 시각에서 세 가지 시나리오별 선택지를 정리해 보겠습니다.

낙관 시나리오는 인공지능 투자가 예상보다 오래 이어지고 추론 확산으로 수요 저변이 넓어지는 경우입니다. 이 경우 선택지는 생산 능력 확보를 최우선에 두는 것입니다. 용인과 청주의 일정을 앞당기고, 장비 발주를 선제적으로 진행하며, 장기공급계약으로 물량과 가격을 미리 확정해 사이클 변동에 대한 방어막을 만듭니다. 동시에 인력 확보를 서두르고, 협력사의 생산 능력까지 함께 키우는 작업을 병행합니다. 위험은 이 시나리오가 틀렸을 때 남는 과잉 설비입니다.

기본 시나리오는 수요 증가세가 완만해지고 경쟁사들이 HBM 시장에 자리 잡아 가격 협상력이 정상화되는 경우입니다. 이 경우 선택지는 두 갈래입니다. 하나는 고부가 제품에서의 기술 격차를 유지하기 위해 차세대 제품 개발에 자원을 집중하는 것이고, 다른 하나는 HBM 외의 이익원을 만드는 것입니다. 기업용 저장 장치, 고용량 서버 모듈, 메모리 확장 제품군 등이 후보입니다. 원가 경쟁력 확보도 이 시나리오에서 중요해집니다. 가격이 정상화되면 원가가 다시 승부처가 되기 때문입니다.

비관 시나리오는 인공지능 투자가 급격히 조정되고 동시에 증설 물량이 시장에 나오는 경우입니다. 이 경우 선택지는 방어에 집중하는 것입니다. 장비 투입을 늦추고, 재무 여력을 지키며, 고부가 제품 비중을 최대한 유지해 평균 이익률을 방어합니다. 감산 결정을 얼마나 빨리 내리느냐가 손실 규모를 좌우합니다. 과거 사이클에서 감산 결정이 늦어 손실이 커진 경험이 있으므로, 이번에는 판단 속도가 중요해집니다.

세 시나리오를 관통하는 공통 선택지도 있습니다. 고객과의 관계를 계약으로 묶어 두는 것입니다. 장기공급계약은 호황기에는 상승분을 일부 포기하는 대가를 치르지만, 불황기에는 물량과 가격의 바닥을 지켜 줍니다. 사이클 산업에서 이익의 변동 폭을 줄이는 가장 실질적인 수단입니다.

● 3-12. 공개 자료의 한계에 관한 고지

이 장을 마무리하며 분석의 한계를 밝혀 두겠습니다.

SK하이닉스는 제품별 매출과 이익을 세분해 공시하지 않습니다. 따라서 D램과 낸드의

비중, HBM의 매출 기여, 고객별 매출 구성 등은 모두 외부 추정치에 의존합니다. 이 보고서에서 인용한 수치들도 시장조사기관과 언론 보도를 통해 확인된 추정치이며, 회사가 확인한 수치가 아닙니다.

고객 구성에 관한 정보도 제한적입니다. 특정 고객의 비중이 얼마인지, 어떤 계약 조건으로 공급하는지는 영업 비밀에 해당해 공개되지 않습니다. 언론 보도로 알려진 내용은 대체로 관계자 인용에 기반하며 정확도에 편차가 있습니다.

조직 구조와 직무 편제에 관한 상세도 공개되지 않습니다. 이 보고서에서 서술한 조직 구조는 채용 공고, 회사가 공개한 임직원 인터뷰, 업계 일반의 편제를 종합해 추론한 것이며, 실제 내부 편제와 다를 수 있습니다.

이런 한계 때문에 이 장의 서술은 회사가 공표한 내용과 검증 가능한 시장 데이터를 근거로 삼되, 그 사이의 빈 곳은 산업 구조와 경쟁사 비교를 통한 해석으로 메웠습니다. 확인되지 않은 사실을 단정하지 않는 것이 이 보고서의 원칙입니다.

● 3-13. 종합 해석과 시사점

3장의 해석을 정리하면 이렇습니다.

SK하이닉스는 지금 매우 좋은 성과를 내고 있지만, 그 성과의 구조는 취약한 면을 함께 갖고 있습니다. 이익이 소수 제품군과 소수 고객에 집중되어 있고, 그 집중이 경쟁 환경의 일시적 조건에 힘입은 부분이 있습니다. 회사가 스스로 이 점을 인식하고 있다는 신호는 여러 곳에서 나타납니다. 제품군 다변화를 강조하고, 단계적 투자 원칙을 반복해 언급하며, 고객과의 관계를 공급에서 협업으로 재정의하려는 시도가 그것입니다.

이 회사를 이해하려면 두 개의 시계를 함께 봐야 합니다. 하나는 분기 단위의 시계입니다. 가격이 오르고 있고 이익이 늘고 있으며 물량이 부족합니다. 다른 하나는 3년에서 5년 단위의 시계입니다. 경쟁사가 따라오고 있고 증설 물량이 준비되고 있으며 수요의 지속 가능성에 물음표가 붙어 있습니다. 두 시계가 서로 다른 이야기를 하고 있으며, 회사의 의사결정은 이 두 시계 사이의 긴장 속에서 이루어집니다.

이 긴장이 이 보고서가 다루는 직무의 업무를 규정합니다. 지금 최대한 벌어야 한다는 요구와 관계를 오래 유지해야 한다는 요구가 충돌하고, 물량을 늘려야 한다는 요구와 수익성을 지켜야 한다는 요구가 충돌합니다. 이 충돌을 데이터와 협상으로 조정하는 일이 이 직무의 실체입니다.

■ 4장: 인재상/조직문화

● 4-1. SK 경영철학이라는 뿌리

SK하이닉스의 인재상을 이해하려면 SK그룹의 경영 체계인 SKMS에서 출발해야 합니다.

SKMS는 SKManagementSystem의 약자로, 그룹이 오랜 기간 정립하고 여러 차례 개정해 온 경영 원칙 체계입니다.

이 체계의 최상위 목적은 구성원의 지속적인 행복에 있습니다. 회사가 존재하는 이유를 이익이나 성장이 아니라 구성원의 행복에 두고, 그 행복을 통해 이해관계자 전체의 행복으로 이어진다는 구조를 제시합니다. 이 목적을 실현하는 방법으로 제시되는 것이 구성원의 자발적이고 의욕적인 몰입이며, 이를 통해 최고 수준의 성과를 만들어 낸다는 흐름입니다.

이 체계는 관념적으로 들릴 수 있으나 실제 인사 제도와 조직 운영에 반영되어 있습니다. 목표를 스스로 설정하게 하는 방식, 구성원 만족도를 조직 평가에 반영하는 방식, 자기 주도 학습을 지원하는 제도 등이 그 예입니다.

● 4-2. VWBE의 의미와 실무적 함의

VWBE는 Voluntarily and Willingly Brain Engagement의 약자입니다. 스스로 원해서, 의욕을 갖고, 두뇌를 활용해 몰입하는 상태를 뜻합니다.

이 개념을 네 단계로 풀면 이렇습니다. 첫째, 용어는 자발적이고 의욕적인 두뇌 활용을 뜻합니다. 둘째, 쉬운 정의로는 시켜서 하는 일과 스스로 하고 싶어서 하는 일의 차이를 가리킵니다. 같은 시간을 들여도 후자의 결과물이 다르다는 전제가 깔려 있습니다. 셋째, 조직에서 중요한 이유는 지식 노동의 성과가 투입 시간이 아니라 몰입의 깊이에 좌우되기 때문입니다. 반도체 사업처럼 판단의 질이 결과를 크게 바꾸는 영역에서는 특히 그렇습니다. 넷째, 이 회사와 직무 맥락에서 보면 제품 계획을 세우고 가격을 협상하고 생산 능력 배분을 조율하는 일은 정해진 절차를 따르는 일이 아닙니다. 상황마다 판단이 다르고 정답이 미리 주어지지 않습니다. 이런 일에서는 스스로 문제를 정의하고 파고드는 태도가 성과를 가릅니다.

실무적으로 이 원칙은 두 가지 방식으로 나타납니다. 하나는 목표 설정의 방식입니다. 위에서 내려온 목표를 받는 것이 아니라 스스로 목표를 제안하고 조율하는 절차를 둡니다. 다른 하나는 학습의 방식입니다. 교육 프로그램을 의무로 부과하기보다 구성원이 스스로 선택하도록 열어 둡니다. 회사가 공개한 내용에 따르면 별도의 홍보 없이도 사내 교육 프로그램의 수강 신청이 몰려 접수 시스템에 부하가 걸릴 정도라고 합니다.

● 4-3. SUPEX의 의미와 실무적 함의

SUPEX는 Super Excellent Level의 줄임말로, 인간의 능력으로 도달할 수 있는 최고 수준을 뜻합니다.

네 단계로 풀면, 첫째 용어는 최고 수준을 가리킵니다. 둘째, 쉬운 정의로는 지금 할 수 있는 수준이 아니라 할 수 있는 최선의 수준을 목표로 삼는다는 뜻입니다. 현재 역량에서 조금 더 나은 목표를 잡는 것이 아니라, 이론적으로 도달 가능한 최고점을 먼저 정하고 거기에 이르는 방법을 찾는 접근입니다. 셋째, 조직에서 중요한 이유는 목표 설정 방식이 결과의 상한을 정하기 때문입니다. 개선형 목표를 잡으면 개선형 결과가 나오고, 도약형 목표를 잡아야 도약형

결과가 나올 여지가 생깁니다. 넷째, 이 회사 맥락에서 보면 HBM 개발 과정이 이 원칙의 사례로 자주 언급됩니다. 후발 주자였던 회사가 특정 제품군에서 세계 최초 공급을 목표로 삼은 것은 개선형 목표가 아니었습니다.

이 원칙의 그림자도 짙어 두겠습니다. 최고 수준을 목표로 삼는 조직은 그만큼 요구 수준이 높고, 성과 압박이 큼니다. 이 문화가 잘 작동하려면 실패에 대한 관용이 함께 있어야 하며, 그렇지 않으면 도전보다 안전한 목표를 택하는 역효과가 생깁니다.

● 4-4. 패기의 의미와 실무적 함의

패기는 SK그룹이 인재상의 핵심으로 제시해 온 표현입니다. 스스로 동기를 부여해 높은 목표에 도전하고, 기존의 틀을 깨는 과감한 실행을 뜻합니다.

네 단계로 풀면, 첫째 용어는 도전 의지와 실행력을 함께 담은 표현입니다. 둘째, 쉬운 정의로는 앞의 두 개념이 밖으로 드러난 모습입니다. 자발적 몰입이 마음의 상태라면, 패기는 그 상태가 행동으로 나타난 것입니다. 셋째, 조직에서 중요한 이유는 아이디어와 실행 사이의 간격을 좁히는 요소이기 때문입니다. 좋은 판단을 내려도 실행되지 않으면 성과가 되지 않습니다. 넷째, 이 회사와 직무 맥락에서 보면 이 직무는 사내 여러 조직을 설득해 움직여야 하는 일입니다. 개발 조직에 일정 조정을 요청하고, 생산 조직에 배분 변경을 설득하고, 경영진에 새로운 제품 계획을 제안하는 일이 반복됩니다. 이 과정에서 반대에 부딪히는 것이 일상이며, 이를 견디고 관철하는 힘이 필요합니다.

● 4-5. 인재상 최신성 교차 검증

인재상을 다룰 때는 최신성 확인이 필요합니다. 과거 시점에 강조되었던 표현이 현재도 유효한지 확인하지 않으면 오래된 정보를 현재의 것으로 오인하게 됩니다. 이 보고서에서는 다음과 같이 정리했습니다.

현재까지 확인 가능한 범위에서 SK그룹의 인재상 체계는 SKMS를 근간으로 하고, 자발적이고 의욕적인 몰입과 최고 수준 추구, 그리고 그 실행으로서의 패기라는 구조를 유지하고 있습니다. 이 세 갈래는 오랜 기간 일관되게 유지되어 온 개념이며, 특정 시기의 유행어가 아닙니다.

반면 시기에 따라 강조점이 바뀌어 온 표현들이 있습니다. 예를 들어 특정 시기에 그룹 차원에서 강조된 경영 키워드나 사업 방향을 담은 표현들은 그 시기의 맥락에서 나온 것으로, 현재의 인재상 기준으로 그대로 옮기는 것은 부정확할 수 있습니다. 이런 표현을 인재상의 항목으로 제시하는 자료들이 온라인에 남아 있으나, 그것이 현재 기준이라는 근거는 확인되지 않습니다.

회사 차원에서는 첨단 기술을 통해 더 나은 세상을 만든다는 취지의 브랜드 정체성을 함께 제시하고 있으며, 기술을 통해 가치를 만드는 일에 참여할 사람을 찾는다는 메시지를 유지하고 있습니다.

정리하면, 확인 가능한 근거를 기준으로 삼을 때 안전한 접근은 SKMS의 세 갈래를 중심으로 두고 이해하는 것입니다. 특정 시기의 경영 키워드를 인재상으로 단정하는 것은 피해야 합니다.

● 4-6. 조직문화의 실제 모습

공식 문서에 적힌 원칙과 실제 조직문화 사이에는 언제나 간격이 있습니다. 공개된 자료에서 확인 가능한 실제 모습을 정리하면 다음과 같습니다.

첫째, 기술 중심 문화입니다. 회사의 정체성이 기술에 있고, 조직 내 논의가 기술적 근거를 중심으로 이루어지는 경향이 있습니다. 사업 조직에서도 기술을 이해하지 못하면 논의에 참여하기 어렵다는 이야기가 반복적으로 나옵니다.

둘째, 협업 중심 문화입니다. 회사는 위기 극복 경험에서 비롯된 원팀 정신을 강조해 왔습니다. 제품 하나를 만드는 데 개발, 제조, 품질, 사업 조직이 모두 관여하며, 자회사와의 협업까지 필요한 경우가 많습니다. 이런 구조에서는 부서 간 조율 역량이 개인 역량만큼 중요해집니다.

셋째, 자기 주도 학습 문화입니다. 반도체 기술은 빠르게 바뀌고, 어제의 지식이 내년에는 통하지 않는 경우가 많습니다. 회사가 교육 제도를 갖추고 있고 구성원의 참여가 활발하다는 점은 이 필요를 반영합니다.

넷째, 성과 압박입니다. 최고 수준을 지향하는 목표 설정 방식과 사이클 산업 특유의 실적 변동성이 겹치면서 성과에 대한 요구가 높은 편입니다. 재직자 평가 자료에서도 업무 강도와 성과 압박을 언급하는 내용이 나타납니다. 이 점은 조직문화의 한 측면으로 균형 있게 인식할 필요가 있습니다.

● 4-7. 이 직무 조직 특유의 문화

같은 회사 안에서도 조직마다 문화가 다릅니다. 사업 조직, 그중에서도 마케팅과 영업 조직의 특성을 정리하면 다음과 같습니다.

첫째, 숫자로 말하는 문화입니다. 이 조직의 논의는 대체로 수요 전망, 가격 시나리오, 수익성 계산을 중심으로 이루어집니다. 감이나 인상으로 주장하면 설득력을 얻기 어렵고, 근거가 되는 데이터를 제시해야 논의가 진행됩니다.

둘째, 시차를 다루는 문화입니다. 고객이 북미와 유럽, 중화권에 걸쳐 있으므로 업무 시간이 국내 근무 시간과 어긋나는 경우가 많습니다. 밤늦은 회의나 이른 아침 대응이 발생하며, 해외 출장 빈도도 상대적으로 높습니다.

셋째, 외부 접점 문화입니다. 개발이나 제조 조직이 사내에서 완결되는 업무 비중이 높다면, 이 조직은 사외 접점이 업무의 중심에 있습니다. 고객사 담당자, 시장조사기관, 파트너사와의 접촉이 일상이며, 그 과정에서 회사를 대표하는 위치에 서게 됩니다.

넷째, 조율의 문화입니다. 이 조직은 스스로 무언가를 만들지 않습니다. 개발이 만들고 제조가 생산합니다. 이 조직이 하는 일은 여러 조직의 결정을 하나의 방향으로 모으는 것이며, 권한보다 설득으로 움직이는 경우가 많습니다.

● 4-8. 채용 조건이 말하는 것

채용 공고에 제시된 조건들은 조직이 실제로 필요로 하는 역량의 신호입니다. 각 항목이 왜 요구되는지를 풀어 보겠습니다.

전기, 전자, 반도체, 컴퓨터, 통계, 산업공학, 경영, 경제 등 관련 전공을 언급한 것은 두 갈래의 배경을 모두 받아들이겠다는 뜻으로 읽힙니다. 앞의 네 전공은 제품과 기술을 이해하는 기반이고, 뒤의 네 전공은 시장과 수익성을 분석하는 기반입니다. 이 직무가 기술과 사업의 경계에 있다는 점이 조건에 그대로 반영되어 있습니다.

영어 소통 능력과 중국어 활용 능력을 언급한 것은 고객 구성을 반영합니다. 인공지능 가속기 설계사와 클라우드 사업자는 대부분 북미 기업이고, 스마트폰과 일부 서버 제조사는 중화권 기업입니다. 계약 문서와 기술 사양서는 영어로 작성되고, 협상 회의도 영어로 진행됩니다.

반도체 기초 공학, 시스템과 컴퓨터 구조, 임베디드 시스템, 인공지능에 대한 이해를 언급한 것은 고객의 시스템 관점에서 제품을 이해해야 한다는 요구입니다. 고객은 메모리 단품을 사는 것이 아니라 시스템의 성능을 사려는 것이므로, 메모리가 시스템 안에서 어떤 역할을 하는지 설명할 수 있어야 합니다.

메모리와 저장 장치의 제어 회로, 로직 해결책, 인터페이스와 상호 연결 구조에 대한 지식을 언급한 것은 특히 신제품 사업화 업무와 관련이 깊습니다. 고객 시스템에 제품을 붙이는 과정에서 문제가 생기면, 그 문제가 메모리 쪽인지 제어 회로 쪽인지 연결 구조 쪽인지 판단해야 논의가 진행됩니다.

하드웨어 설계와 소프트웨어에 대한 이해를 바탕으로 고객과 유관 부서와 기술적으로 소통할 수 있어야 한다는 조건은 이 직무의 본질을 가장 잘 보여 줍니다. 스스로 설계하라는 것이 아니라, 설계하는 사람들의 언어를 알아듣고 옮길 수 있어야 한다는 뜻입니다.

재무제표 지식과 데이터 기반 분석을 통한 전략 수립과 사업적 통찰 도출을 언급한 것은 이 조직이 손익에 대한 책임을 진다는 점을 보여 줍니다. 제품별 수익성, 고객별 기여도, 투자 대비 효과를 계산할 수 있어야 하고, 그 계산이 회사의 자원 배분 결정으로 이어집니다.

영업과 사업 전략 수립을 위한 분석적 사고를 언급한 것은 앞의 조건들을 종합하는 능력을 가리킵니다. 개별 데이터를 모으는 것과 그것으로 결론을 만드는 것은 다른 일이며, 이 조직이 필요로 하는 것은 후자입니다.

● 4-9. 이 도메인에서 성과를 내는 사람의 특성

산업과 직무의 성격에서 자연스럽게 도출되는 인재 특성을 정리하겠습니다.

첫째, 긴 시간 지평을 건디는 태도입니다. 제품 하나가 기획에서 양산까지 가는 데 2년 안팎이 걸립니다. 오늘 세운 계획의 결과를 2년 뒤에 확인하게 되며, 그 사이에 시장이 여러 번 바뀝니다. 짧은 주기의 성취감을 필요로 하는 사람에게는 답답한 구조일 수 있습니다.

둘째, 불확실성 속에서 결정하는 능력입니다. 2년 뒤의 시장을 정확히 알 수 있는 사람은 없습니다. 그럼에도 지금 결정을 내려야 하고, 그 결정에 조 단위 투자가 따라붙습니다. 완벽한 정보를 기다리기보다 가진 정보로 최선의 판단을 내리고 그 판단을 필요할 때 수정하는 태도가 요구됩니다.

셋째, 거절을 건디는 힘입니다. 영업 활동은 거절의 연속입니다. 고객의 요구는 대체로 회사가 감당하기 어려운 수준이고, 회사의 제안은 대체로 고객이 받아들이기 어려운 수준입니다. 그 간격을 여러 차례의 대화로 좁혀 나가는 과정이 이 일의 실체입니다.

넷째, 번역 능력입니다. 기술 언어와 사업 언어, 국내 조직의 맥락과 해외 고객의 맥락, 개발 조직의 관심사와 경영진의 관심사 사이를 오가며 같은 내용을 상대에 맞게 옮길 수 있어야 합니다. 이 능력은 지식의 양이 아니라 상대의 입장을 파악하는 감각에서 나옵니다.

다섯째, 사실에 기반한 태도입니다. 이 조직에서 만들어지는 자료는 회사의 자원 배분 결정에 쓰입니다. 근거가 약한 전망이 결정에 반영되면 그 대가가 큼니다. 자신이 모르는 것을 모른다고 말하고, 추정과 확인된 사실을 구분해 제시하는 태도가 신뢰를 만듭니다.

여섯째, 협업에서의 신뢰 구축입니다. 이 조직은 다른 조직의 협조 없이는 아무것도 할 수 없습니다. 개발 조직이 일정을 앞당겨 줘야 하고, 제조 조직이 생산 능력을 내줘야 하며, 품질 조직이 검증을 서둘러 줘야 합니다. 이런 협조는 권한으로 얻어지지 않고 관계로 얻어집니다.

● 4-10. 종합 해석과 시사점

4장의 해석은 다음과 같습니다.

SK하이닉스의 인재상은 추상적 덕목의 나열이 아니라 사업의 성격에서 도출된 요구로 읽어야 합니다. 자발적 몰입을 강조하는 것은 이 산업의 일이 정답이 정해져 있지 않기 때문이고, 최고 수준을 지향하는 것은 기술 격차가 곧 이익 격차가 되기 때문이며, 실행력을 강조하는 것은 판단이 실행으로 옮겨지는 속도가 시장 선점을 좌우하기 때문입니다.

이 직무에 한정해 보면 요구되는 특성은 더 구체적입니다. 기술을 이해하되 스스로 개발하지는 않고, 숫자를 다루되 회계 담당자와는 다른 방식으로 다루며, 고객을 상대하되 소비재 영업과는 다른 방식으로 상대합니다. 이 경계에 서 있는 일이라는 점을 이해하는 것이 이 직무를 이해하는 출발점입니다.

인재상을 다룰 때 유의할 점 하나를 덧붙이면, 조직이 공표한 표현과 조직 안에서 실제로 작동하는 규범이 완전히 같지는 않다는 것입니다. 공표된 표현은 조직이 지향하는 방향을 보여 주고, 실제 규범은 그 방향과 현실의 제약이 타협한 결과입니다. 두 가지를 함께 보아야

조직을 정확히 이해할 수 있습니다.

■ 5장: 직무 분석

● 5-1. 이 포지션의 정확한 범위

먼저 이 직무가 무엇이고 무엇이 아닌지를 명확히 하겠습니다.

이 포지션은 영업, 마케팅, 상품기획, 신제품 사업화라는 네 개 업무 영역을 하나의 채용 단위로 묶은 것입니다. 근무지는 이천과 서울입니다. 채용 공고가 설명하는 이 조직의 존재 이유는 고객과 시장, 기술 흐름을 바탕으로 제품 전략과 제품군을 기획하고, 신제품 인증과 시장 출시 시점을 관리해 경쟁력 있는 제품을 제때 내놓는 것입니다. 그 과정에서 신제품의 가치와 차별성을 전달해 사업을 넓히고 수익성을 극대화하며, 중장기 전략에 부합하는 신사업 기회와 파트너 협업을 발굴합니다.

이 직무가 아닌 것을 먼저 정리하면 이해가 빨라집니다. 이 일은 반도체를 설계하는 일이 아닙니다. 회로 설계와 소자 개발은 개발 조직의 업무입니다. 이 일은 공정을 개선하고 수율을 올리는 일이 아닙니다. 그것은 제조와 양산 기술 조직의 업무입니다. 이 일은 완제품을 소비자에게 홍보하는 일도 아닙니다. 최종 소비자를 상대하는 광고나 브랜드 캠페인과는 성격이 다릅니다. 이 일은 재무 회계 업무도 아닙니다. 손익을 계산하지만 결산이나 공시를 담당하지는 않습니다.

이 직무가 무엇인지 한 문장으로 정리하면, 고객과 시장의 요구를 제품 계획으로 바꾸고, 그 제품이 고객 시스템에 채택되도록 만들며, 판매 조건을 협상해 회사 손익으로 연결하는 일입니다.

● 5-2. 네 갈래의 관계와 업무 흐름

네 개 업무 영역은 하나의 흐름으로 이어져 있습니다.

상품기획은 흐름의 맨 앞에 있습니다. 시장과 기술 흐름을 분석해 앞으로 무엇을 만들어야 하는지 정하고, 중장기 제품 계획을 세우며, 고객과 파트너의 요구를 반영해 목표 사양을 정의합니다. 여기서 나온 계획이 개발 조직의 작업 지시가 됩니다.

신제품 사업화는 그다음입니다. 기획된 제품이 실제로 만들어지면 그것을 고객 시스템에 안착시키는 일을 말합니다. 고객 인증 절차를 관리하고, 기술적 문제가 생기면 사내 개발 조직과 고객 사이를 오가며 해결하며, 언제 어느 고객에게 어떤 순서로 공급을 시작할지 계획합니다.

마케팅은 판매의 설계를 담당합니다. 시장 환경과 기술 흐름을 반영해 중장기 판매 전략을 세우고, 사업 계획과 실제 판매 실행을 관리하며, 세대 전환 시점의 제품 교체 전략을 지원합니다. 시장 데이터와 수익성 분석을 통해 판단의 근거를 만들고, 제품의 가치를 시장에

전달할 메시지를 정리합니다.

영업은 고객 접점에서의 실행을 담당합니다. 고객과 지속적으로 소통하며 요구를 파악하고, 시장과 고객과 경쟁사 정보를 분석해 영업 전략을 세우며, 신규 시장과 고객을 발굴하고, 수요와 공급을 관리해 매출을 만듭니다.

실무에서 이 네 영역은 칼로 자르듯 나뉘지 않습니다. 담당자 한 사람이 여러 영역을 함께 맡는 경우가 흔하고, 특히 특정 제품군을 전담하는 경우에는 기획부터 판매까지 이어서 담당하기도 합니다. 채용 단위가 하나로 묶여 있는 것도 이런 현실을 반영한 것으로 볼 수 있습니다.

● 5-3. 상품기획 업무의 실제

상품기획 업무를 구체적으로 풀어 보겠습니다.

출발점은 정보 수집입니다. 시장조사기관의 전망 자료, 고객사가 공개한 기술 계획, 국제 표준 기구의 규격 논의 진행 상황, 경쟁사의 제품 발표, 학회에서 발표되는 기술 동향을 모읍니다. 여기서 중요한 것은 자료를 모으는 일이 아니라 자료 사이의 불일치를 발견하는 일입니다. 시장조사기관의 전망과 고객의 실제 발주 계획이 다를 때, 그 차이가 어디서 오는지 파악하는 것이 분석의 시작입니다.

다음은 제품 계획 수립입니다. 앞으로 2년에서 5년 사이에 어떤 제품을 언제 내놓을지 정합니다. 여기에는 여러 제약이 걸립니다. 개발 조직의 역량과 일정, 생산 조직의 능력, 국제 표준의 확정 시점, 고객의 시스템 개발 일정이 모두 맞물려야 합니다. 하나라도 어긋나면 계획이 무너집니다.

목표 사양 정의는 특히 까다로운 작업입니다. 고객이 원하는 성능과 회사가 만들 수 있는 성능 사이에 간격이 있고, 그 간격을 어떻게 좁힐지 협의해야 합니다. 성능을 높이면 원가가 오르고 발열이 늘며 수율이 떨어집니다. 어느 지점에서 타협할지 정하는 것이 이 업무의 핵심 판단입니다.

여기서 국제 표준이라는 변수를 짚어야 합니다. 메모리 규격은 국제 반도체 표준화 기구에서 논의를 거쳐 확정됩니다. 표준이 확정되면 모든 회사가 그 규격에 맞춰 제품을 만들므로 호환성이 확보됩니다. 상품기획 조직은 이 표준화 논의에 참여해 회사에 유리한 방향으로 규격이 정해지도록 의견을 내고, 동시에 확정될 규격을 예측해 개발 일정을 앞당깁니다. 표준이 확정된 뒤에 개발을 시작하면 늦기 때문입니다.

기술 소통도 이 업무의 일부입니다. 회사가 개발한 기술의 의미를 고객이 이해할 수 있는 언어로 정리하고, 학회나 전시회에서 발표하며, 기술 자료를 만듭니다. 기술 자체는 개발 조직이 만들지만, 그 기술이 왜 고객에게 이점이 되는지를 설명하는 일은 이 조직의 몫입니다.

● 5-4. 신제품 사업화 업무의 실제와 고객 인증

신제품 사업화 업무의 중심에는 고객 인증이 있습니다. 이 개념을 충분히 풀어 보겠습니다.

첫째, 용어는 고객이 공급사의 제품을 자사 시스템에서 검증하고 승인하는 절차를 가리킵니다. 업계에서는 퀄리피케이션이라 부르며, 줄여서 퀄이라 하기도 합니다. 둘째, 쉬운 정의로는 납품 자격을 얻기 위한 시험입니다. 공급사가 아무리 좋은 제품을 만들어도 고객이 자사 시스템에서 검증해 통과시키지 않으면 팔 수 없습니다. 셋째, 산업적으로 중요한 이유는 이 절차가 사실상의 진입 장벽으로 작동하기 때문입니다. 인공지능 가속기처럼 복잡한 시스템에서는 메모리 하나의 문제가 시스템 전체의 오작동으로 이어질 수 있으므로 검증이 까다롭고 오래 걸립니다. 통과하지 못하면 매출은 영입입니다. 특정 세대에서 경쟁사가 주도권을 잃은 것도 이 절차의 지연 때문이었습니다. 넷째, 이 회사와 직무 맥락에서 인증 절차를 관리하고 통과 시점을 앞당기는 것이 신제품 사업화 업무의 핵심 성과 지표입니다.

인증 절차는 대략 다음과 같이 진행됩니다. 먼저 고객에게 시제품을 제공합니다. 고객은 이를 자사 시스템에 붙여 온도, 전압, 속도 등 다양한 조건에서 시험합니다. 문제가 발견되면 공급사에 통보하고, 공급사는 원인을 분석해 대책을 제시합니다. 이 과정이 여러 차례 반복되며, 모든 항목이 기준을 충족하면 승인이 나옵니다. 승인 이후에도 양산 초기에는 밀착 관리가 이어집니다.

이 과정에서 신제품 사업화 담당자가 하는 일은 조율입니다. 고객이 발견한 문제를 사내 개발 조직에 정확히 전달해야 하는데, 고객이 보는 현상과 회사가 이해하는 원인은 다른 언어로 표현됩니다. 이 번역이 부정확하면 잘못된 대책이 나오고 시간이 낭비됩니다. 또한 여러 고객의 인증이 동시에 진행될 때 어느 고객을 먼저 지원할지 우선순위를 정해야 하고, 개발 조직의 자원은 한정되어 있으므로 조율이 필요합니다.

사업화 전략 최적화도 이 업무에 포함됩니다. 신제품을 어느 고객에게 먼저 공급할지, 초기 물량을 어떻게 배분할지, 기존 제품에서 신제품으로 언제 전환할지 정하는 일입니다. 신제품은 초기 수율이 낮아 원가가 높으므로, 무작정 물량을 늘리기보다 수율 개선 곡선을 보며 단계적으로 확대하는 판단이 필요합니다.

● 5-5. 마케팅 업무의 실제

마케팅 업무의 중심에는 수요와 공급의 조율이 있습니다. 이를 업계에서는 판매 및 운영 계획, 줄여서 에스앤오피라 부릅니다.

이 개념을 네 단계로 풀면, 첫째 용어는 판매 계획과 생산 운영 계획을 하나로 맞추는 절차를 뜻합니다. 둘째, 쉬운 정의로는 얼마나 팔릴지와 얼마나 만들 수 있는지를 한 회의에서 맞춰 보는 과정입니다. 셋째, 산업적으로 중요한 이유는 메모리 생산이 몇 달의 시간이 걸리기 때문입니다. 지금 웨이퍼를 투입해야 몇 달 뒤에 제품이 나오므로, 몇 달 뒤의 수요를 지금 예측해 생산 계획에 반영해야 합니다. 예측이 빗나가면 재고가 쌓이거나 물량이 부족해집니다. 넷째, 이 회사와 직무 맥락에서 물량이 부족한 국면에서는 이 절차가 배분 회의의 성격을 띠니다. 만들 수 있는 양이 정해져 있으므로 어느 고객과 어느 제품에 얼마를 줄지가 논의의

중심이 됩니다.

가격 관리도 마케팅의 핵심 업무입니다. 메모리 가격은 계약 형태에 따라 다르게 정해집니다. 현물 시장 가격은 매일 변동하지만 대형 고객과의 거래는 대체로 분기 단위 또는 그 이상의 계약으로 이루어집니다. 계약 협상에서는 시장 전망, 경쟁사 동향, 고객의 대안, 자사 생산 능력이 모두 고려됩니다.

세대 전환 관리도 마케팅의 업무입니다. 새 공정으로 만든 제품이 나오면 구세대 제품에서 신세대 제품으로 판매를 옮겨야 합니다. 이때 두 가지를 맞춰야 합니다. 하나는 생산 측면입니다. 구세대 라인을 신세대로 전환하면 그 기간 동안 생산이 줄어듭니다. 다른 하나는 고객 측면입니다. 고객이 신세대 제품을 쓰려면 인증을 다시 받아야 하고, 그 시점이 고객마다 다릅니다. 전환이 너무 빠르면 구세대를 원하는 고객에게 공급하지 못하고, 너무 늦으면 원가 개선 효과를 놓칩니다.

수익성 분석도 이 조직의 업무입니다. 제품별 원가와 판매가를 비교해 어떤 제품이 얼마의 이익을 만드는지 계산하고, 이를 근거로 생산 능력 배분과 가격 정책을 제안합니다. 이 분석이 채용 요건에 재무제표 지식이 포함된 이유입니다.

● 5-6. 영업 업무의 실제와 장기공급계약

영업 업무를 이해하려면 기업 간 거래의 성격을 알아야 합니다.

메모리 영업은 소비재 영업과 완전히 다릅니다. 고객 수가 적고, 한 고객의 규모가 크며, 관계가 오래 이어집니다. 새로운 고객을 찾아다니기보다 기존 고객과의 관계를 깊게 만드는 데 더 많은 시간이 들어갑니다. 한 번의 협상 결과가 수천억 원 규모의 손익 차이를 만들기도 합니다.

여기서 장기공급계약이라는 개념이 나옵니다. 첫째, 용어는 여러 분기 또는 여러 해에 걸친 물량과 가격 조건을 미리 확정하는 계약을 뜻하며, 업계에서는 엘티에이라 부릅니다. 둘째, 쉬운 정의로는 시세가 크게 출렁이는 시장에서 미리 거래 조건을 묶어 두는 약속입니다. 셋째, 산업적으로 중요한 이유는 양쪽 모두에게 예측 가능성을 주기 때문입니다. 고객은 물량 확보를 보장받고, 공급사는 생산 계획과 투자 계획을 안정적으로 세울 수 있습니다. 넷째, 이 회사와 직무 맥락에서 2026년 상반기에 다수 고객과 장기 계약 협상이 진행된 것으로 알려져 있으며, 이는 회사의 실적 안정성에 중요한 기반이 됩니다.

장기공급계약에는 대가가 따릅니다. 가격이 크게 오르는 국면에서는 시장가보다 낮은 가격에 팔게 되어 단기 이익을 일부 포기하게 됩니다. 반대로 가격이 떨어지는 국면에서는 시장가보다 높은 가격을 유지할 수 있어 손실을 줄입니다. 이 계약을 언제 어떤 조건으로 맺을지 판단하는 것이 영업의 핵심 역량입니다.

신규 시장과 고객 발굴도 영업의 업무입니다. 기존 고객만 상대하면 성장에 한계가 있고, 특정 고객 의존이 심해집니다. 새로운 응용 분야에서 메모리 수요가 생기는지 살피고, 아직

거래하지 않는 기업과 접점을 만드는 작업이 이어집니다. 인공지능 전용 반도체를 자체 설계하는 클라우드 사업자들이 늘어나면서 이런 발굴의 중요성이 커졌습니다.

● 5-7. 고객 유형별 대응 방식의 차이

이 직무를 깊이 이해하려면 고객마다 대응 방식이 다르다는 점을 알아야 합니다.

인공지능 가속기 설계사는 기술 요구가 가장 까다로운 고객입니다. 제품 개발 초기 단계부터 협업이 시작되고, 사양 협의에 많은 시간이 들며, 인증 절차가 길고 엄격합니다. 이 고객군과의 거래는 사실상 공동 개발에 가깝고, 담당자에게 요구되는 기술 이해도가 가장 높습니다.

클라우드 사업자는 규모가 크고 자체 기술 역량이 강한 고객입니다. 최근에는 스스로 반도체를 설계하는 경우가 늘어, 메모리 회사와 직결되는 관계가 만들어지고 있습니다. 이들은 총소유비용과 전력 효율을 중시하며, 구매 결정에 데이터 기반 검토가 깊이 관여합니다.

서버 제조사는 전통적인 고객군입니다. 표준 제품을 대량으로 구매하고, 가격 협상이 비교적 정형화되어 있습니다. 다만 최근에는 인공지능 서버 비중이 늘면서 요구 사양이 복잡해지고 있습니다.

스마트폰 제조사는 물량이 크고 일정이 촘촘한 고객입니다. 신제품 출시 일정이 정해져 있어 공급 지연을 허용하지 않으며, 원가 압박이 커서 가격 협상이 치열합니다. 국내 기업과 중화권 기업이 주요 고객이며, 중화권 대응에 중국어 역량이 필요한 이유가 여기 있습니다.

유통 채널을 통한 판매도 존재합니다. 소규모 고객이나 특정 지역 시장은 대리점을 통해 공급되며, 이 경로는 직거래와 다른 관리 방식을 요구합니다.

각 고객군의 구매 결정 구조도 다릅니다. 어떤 고객은 기술 담당자의 평가가 결정적이고, 어떤 고객은 구매 담당자의 가격 판단이 결정적이며, 어떤 고객은 경영진 차원의 전략적 판단이 개입합니다. 누구를 설득해야 하는지를 파악하는 것이 영업 활동의 출발점입니다.

● 5-8. 이해관계자 지도

사내에서 협업하는 조직을 정리하겠습니다.

개발 조직과는 제품 사양과 개발 일정을 논의합니다. 고객이 요구하는 사양이 기술적으로 가능한지, 언제까지 가능한지를 확인하고, 고객이 발견한 문제의 원인 분석을 요청합니다.

제조 조직과는 생산 능력과 일정을 논의합니다. 어떤 제품을 얼마나 만들 수 있는지, 세대 전환을 언제 할지, 특정 고객 물량을 앞당길 수 있는지를 협의합니다.

품질 조직과는 인증 대응과 문제 처리를 함께합니다. 고객이 제기한 품질 사안에 대한 공식 대응 문서를 만들고, 재발 방지 대책을 정리합니다.

수익성 관리 조직과는 원가와 손익을 논의합니다. 특정 가격에 팔았을 때 얼마의 이익이 남는지, 어떤 제품 구성이 유리한지를 함께 계산합니다.

구매 조직과는 원자재와 부품 조달을 논의합니다. 특히 외부 파운드리에서 조달하는 부품이 있는 제품은 조달 일정이 제품 공급 일정을 좌우합니다.

법무와 재무 조직과는 계약 조건을 검토합니다. 장기 계약의 조항, 위약 조건, 대금 조건 등은 법무 검토를 거쳐야 합니다.

자회사와는 제품군 조정과 공동 제안을 협의합니다.

사외 이해관계자로는 인공지능 가속기 설계사, 클라우드 사업자, 서버 제조사, 스마트폰 제조사, 유통 파트너, 파운드리 파트너, 저장 장치 협력사, 국제 표준화 기구, 시장조사기관 등이 있습니다. 시장조사기관과의 관계는 정보를 얻는 통로이자 시장에 메시지를 전하는 통로이기도 합니다.

● 5-9. 하루, 한 달, 한 해의 업무 리듬

하루 단위로 보면 이 직무의 시간은 크게 세 갈래로 나뉩니다. 첫째는 정보 확인입니다. 밤사이 해외 고객에게서 온 연락, 시장 가격 동향, 경쟁사 소식을 확인합니다. 둘째는 회의입니다. 사내 조직과의 조율 회의, 고객과의 협의를 이어집니다. 셋째는 분석과 문서 작업입니다. 수요 예측을 갱신하고, 수익성을 계산하며, 제안 자료를 만듭니다.

한 달 단위로 보면 수요와 공급 조율 절차가 중심에 있습니다. 월 단위로 수요 전망을 갱신하고 생산 계획에 반영하는 회의가 진행되며, 제품별 판매 실적과 계획 대비 차이를 점검합니다. 고객사 방문과 정기 협의도 월 단위로 이루어지는 경우가 많습니다.

분기 단위로는 가격 협상이 있습니다. 다음 분기의 공급 조건을 정하는 협상이 진행되고, 그 결과가 회사 손익에 반영됩니다. 분기 실적 발표를 앞두고 사업 현황을 정리하는 작업도 이 주기에 포함됩니다.

한 해 단위로는 사업 계획 수립이 있습니다. 다음 해의 매출과 이익 목표를 세우고, 제품별 물량과 가격 계획을 짜며, 필요한 생산 능력을 산정합니다. 이 계획이 회사의 투자 결정과 연결됩니다.

더 긴 주기로는 제품 계획 갱신이 있습니다. 2년에서 5년 뒤에 내놓을 제품의 구성을 정하고, 기술 흐름의 변화에 맞춰 계획을 수정합니다. 이 작업의 결과는 몇 년 뒤에야 확인됩니다.

● 5-10. 필요 역량, 기술과 지식

기술과 지식 측면에서 요구되는 것을 정리하겠습니다.

반도체 기초 지식은 필수입니다. D램과 낸드의 구조와 동작 원리, 미세공정과 적층 기술의 의미, 수율과 원가의 관계를 이해해야 합니다. 이 지식이 없으면 개발 조직과의 대화가 성립하지 않습니다.

시스템 관점의 이해가 필요합니다. 메모리가 컴퓨터 시스템 안에서 어떤 역할을 하는지, 연산 장치와 어떻게 연결되는지, 인터페이스 규격이 무엇을 규정하는지를 알아야 고객의 요구를 이해할 수 있습니다.

인공지능 연산의 기초 이해도 요구됩니다. 인공지능 모델이 어떤 방식으로 계산을 수행하고 왜 대역폭이 중요한지를 알아야 고객이 왜 그 사양을 요구하는지 설명할 수 있습니다.

시장 분석 역량이 필요합니다. 수요 전망을 만들고, 시장조사기관 자료의 가정을 검증하며, 경쟁사 동향을 해석하는 작업이 일상입니다.

재무 지식이 필요합니다. 손익계산서의 구조, 원가와 판매가의 관계, 투자 대비 회수 계산을 이해해야 사업 판단에 참여할 수 있습니다.

데이터 처리 역량이 요구됩니다. 대량의 판매 데이터와 시장 데이터를 다루고, 이를 정리해 결론을 도출하는 작업이 늘고 있습니다.

언어 역량은 도구입니다. 영어는 업무 수행의 기본 조건이고, 중국어는 특정 고객군 대응에서 이점이 됩니다.

● 5-11. 필요 역량, 소프트스킬

기술 외의 역량을 정리하겠습니다.

협상 역량이 첫 번째입니다. 상대의 대안과 제약을 파악하고, 양보할 것과 지킬 것을 구분하며, 관계를 해치지 않으면서 조건을 개선하는 능력입니다. 일회성 거래가 아니라 오래 이어질 관계이므로, 이기는 협상보다 지속 가능한 협상이 중요합니다.

설득 역량이 두 번째입니다. 사내 조직을 움직여야 하는데 이 조직에는 그럴 권한이 없습니다. 데이터와 논리로 상대를 납득시키는 방법밖에 없습니다.

문서화 역량이 세 번째입니다. 논의된 내용을 정리하고, 판단의 근거를 남기며, 다른 사람이 이해할 수 있는 형태로 만드는 능력입니다. 여러 조직이 관여하는 업무에서 문서는 협업의 기반이 됩니다.

우선순위 판단이 네 번째입니다. 요청은 항상 자원보다 많습니다. 무엇을 먼저 하고 무엇을 미룰지 결정해야 하며, 그 결정을 관련자에게 설명할 수 있어야 합니다.

불확실성 감내가 다섯 번째입니다. 정보가 부족한 상태에서 결정을 내려야 하고, 그 결정이 틀렸을 가능성을 안고 진행해야 합니다.

문화 감각이 여섯 번째입니다. 서로 다른 나라의 기업 문화를 상대하며, 표현 방식과 의사결정 방식의 차이를 이해해야 오해를 줄일 수 있습니다.

● 5-12. 성과 지표와 평가 요소

이 직무의 성과가 어떻게 측정되는지 추론해 보겠습니다. 회사가 공식적으로 공개한 내용이

아니므로 산업 일반의 관행을 근거로 한 추정임을 밝혀 둡니다.

매출과 점유율은 기본 지표입니다. 담당 제품군 또는 담당 고객의 매출 규모와 시장 내 위치가 평가의 출발점이 됩니다.

평균 판매 가격은 협상 성과를 보여 주는 지표입니다. 같은 물량을 팔아도 가격이 다르면 이익이 달라지므로, 가격 관리 성과가 별도로 평가됩니다.

물량 성장률은 비트 단위로 측정됩니다. 시장 성장률과 비교해 자사 성장이 앞서는지 뒤처지는지를 봅니다.

수익성 지표가 중요합니다. 물량이 부족한 국면에서는 얼마나 파느냐보다 어떤 조합으로 파느냐가 이익을 좌우하므로, 제품 구성과 고객 구성의 최적화가 평가 대상이 됩니다.

신제품 채택 성과가 있습니다. 담당 제품이 고객 시스템에 채택되었는지, 인증을 계획대로 통과했는지가 사업화 업무의 핵심 성과입니다.

계약 성과가 있습니다. 장기 계약을 얼마나 확보했는지, 그 조건이 회사에 유리한지가 평가됩니다.

재고 관리 지표도 포함됩니다. 수요 예측이 정확하면 재고가 적정하게 유지되고, 빗나가면 재고가 쌓이거나 물량이 부족해집니다.

정성적 평가 요소로는 고객 관계의 질, 사내 협업 평판, 시장 정보의 정확성 등이 반영될 수 있습니다.

● 5-13. 가상의 업무 흐름

한 담당자의 하루를 구체적으로 그려 보겠습니다. 이해를 돕기 위한 구성이며 실제 회사의 업무 절차와는 다를 수 있습니다.

오전 8시, 출근하자마자 밤사이 들어온 연락을 확인합니다. 북미 고객사 구매 담당자가 다음 분기 고대역폭 메모리 물량을 당초 계획보다 늘려 달라는 요청을 보냈습니다. 요청 물량은 현재 배정된 양의 1.3배입니다.

오전 9시, 사내 시스템에서 생산 계획을 확인합니다. 요청 물량을 맞추려면 다른 고객에게 배정된 물량을 줄이거나, 일반 D램 생산에 쓰기로 한 웨이퍼를 돌려야 합니다. 두 가지 선택지의 손익 차이를 계산합니다. 고대역폭 메모리는 단위당 이익이 높지만 웨이퍼 소모가 크고, 일반 D램은 단위당 이익이 낮지만 웨이퍼 효율이 좋습니다. 최근 일반 D램 가격이 급등한 탓에 계산이 단순하지 않습니다.

오전 10시 30분, 상품기획 담당자와 생산 계획 담당자가 참여하는 회의에 들어갑니다. 계산 결과를 공유하고 세 가지 안을 제시합니다. 첫째, 요청을 전부 수용하되 다른 고객 물량을 줄이는 안. 둘째, 절반만 수용하는 안. 셋째, 다음 분기가 아니라 그다음 분기부터 늘리는

안. 회의에서는 다른 고객과의 관계, 장기 계약 조건, 생산 전환에 필요한 시간이 함께 검토됩니다.

오후 1시, 신제품 사업화 담당자와 인증 진행 상황을 점검합니다. 다른 고객사의 인증 절차에서 특정 온도 조건의 시험 항목이 통과되지 않았다는 보고가 있습니다. 고객이 전달한 시험 데이터를 함께 살펴보고, 개발 조직에 전달할 내용을 정리합니다. 이때 중요한 것은 고객이 관찰한 현상과 추정 원인을 구분해 전달하는 일입니다. 고객의 추정을 사실처럼 전달하면 잘못된 방향으로 분석이 진행됩니다.

오후 3시, 다음 분기 가격 협상을 준비합니다. 시장조사기관의 가격 전망, 경쟁사의 공급 여력에 관한 정보, 고객의 대안 확보 상황을 정리해 협상 자료를 만듭니다. 어느 수준까지 양보할 수 있는지 내부 기준을 정하고, 그 근거를 문서로 남깁니다.

오후 5시, 제품 계획 회의 자료를 검토합니다. 다음 세대 제품의 목표 사양에 관해 고객사가 보내온 의견이 여러 건 있는데, 서로 상충하는 요구가 섞여 있습니다. 어느 요구를 반영할지 판단하려면 각 고객의 예상 물량과 전략적 중요도를 함께 봐야 합니다.

저녁 8시, 북미 고객과의 화상 회의에 들어갑니다. 오전에 검토한 물량 요청에 대한 회사 입장을 전달하고, 조건을 논의합니다. 시차 때문에 이 시간대의 회의는 드물지 않습니다.

이 하루를 관통하는 것은 판단입니다. 정해진 절차를 수행하는 시간보다 무엇을 선택할지 고민하는 시간이 더 깁니다. 그리고 그 판단의 근거는 대부분 숫자입니다.

● 5-14. 이 직무의 경력 경로

이 직무에 들어선 사람이 밟게 되는 경로를 살펴보겠습니다.

초기에는 특정 제품군이나 특정 고객군을 담당하며 실무를 익힙니다. 수요 데이터를 정리하고, 회의 자료를 만들고, 선임자를 따라 고객 협의에 참여하며 업무의 흐름을 파악합니다. 이 단계에서는 산업의 언어와 사내 절차를 익히는 것이 중심입니다.

중간 단계에서는 담당 범위가 넓어집니다. 특정 고객과의 협상을 주도하거나, 특정 제품군의 계획을 책임집니다. 사내 여러 조직과의 조율을 스스로 이끌어야 하고, 판단의 결과에 대한 책임을 지게 됩니다.

그 이후에는 갈래가 나뉩니다. 하나는 사업 총괄 방향입니다. 여러 제품군과 여러 고객을 아우르는 사업 단위를 맡아 손익을 책임집니다. 다른 하나는 전문가 방향입니다. 특정 영역, 예를 들어 제품 기획이나 시장 분석에서 깊이를 쌓아 조직의 판단을 뒷받침하는 역할을 합니다. 또 다른 갈래로는 해외 법인이나 자회사로 이동해 다른 시장을 담당하는 경로도 있습니다.

이 직무에서 쌓이는 역량은 회사 밖에서도 통용되는 성격을 갖습니다. 기술 이해와 사업 판단을 함께 다루는 경험, 대형 기업 간 협상 경험, 글로벌 고객 대응 경험은 다른 산업의

유사 직무에서도 인정받는 자산입니다.

● 5-15. 종합 해석과 시사점

5장의 해석을 정리하면 이렇습니다.

이 직무의 본질은 정보를 판단으로, 판단을 조직의 행동으로 바꾸는 것입니다. 정보 자체는 누구나 접근할 수 있습니다. 시장조사기관 자료는 돈을 내면 살 수 있고, 경쟁사 소식은 언론에 나옵니다. 차이를 만드는 것은 그 정보들 사이의 어긋남을 발견하고, 그 어긋남이 무엇을 뜻하는지 해석하며, 그 해석을 근거로 조직을 움직이는 능력입니다.

이 직무가 어려운 이유는 세 가지 성격이 한 사람에게 동시에 요구되기 때문입니다. 기술을 이해하는 사람의 정확성, 시장을 읽는 사람의 감각, 협상하는 사람의 담대함이 함께 필요합니다. 이 세 가지를 모두 갖춘 사람은 드물기 때문에, 조직은 대체로 강점이 다른 사람들을 모아 팀을 구성합니다.

2026년이라는 시점이 이 직무에 부여한 특수성도 있습니다. 물량이 부족한 국면에서는 파는 일보다 배분하는 일이 중심이 되고, 관계를 유지하는 일이 물량을 늘리는 일보다 중요해집니다. 지금 물량을 주지 못한 고객이 다음 국면에서 다른 공급사를 선택할 수 있기 때문입니다. 호황기의 판단이 불황기의 결과를 만든다는 점을 인식하는 것이 이 직무의 성숙도를 가르는 요소입니다.

■ 핵심 용어·개념 정리 (Glossary)

D램: 전원이 켜져 있을 때만 데이터를 보관하는 휘발성 메모리. 메모리 시장의 최대 영역이며 SK하이닉스 매출의 대략 3분의 2를 차지합니다.

낸드플래시: 전원이 꺼져도 데이터가 남는 비휘발성 메모리. 저장 장치의 기반이며 인공지능 추론 확산으로 수요가 재평가되고 있습니다.

HBM: D램을 수직으로 쌓아 대역폭을 크게 높인 인공지능 가속기용 메모리. SK하이닉스 이익 대부분을 만들어 내는 제품군입니다.

HBM4: 6세대 고대역폭 메모리. 베이스 다이가 로직 수준으로 복잡해져 파운드리 협업이 필요해진 첫 세대입니다.

TSV: 칩을 수직으로 관통해 층 사이를 연결하는 전극 기술. 적층 메모리를 가능하게 만든 기반 기술입니다.

MR-MUF: 쌓아 올린 칩 사이를 보호재로 한 번에 채워 굳히는 패키징 방식. 발열과 구조 안정성 확보에 유리합니다.

ASP: 평균 판매 가격. 물량이 같아도 이 값이 달라지면 실적이 크게 달라지므로 사업 조직의 핵심

성과 지표입니다.

비트그로스: 판매하거나 생산한 용량을 비트 단위로 환산한 증가율. 가격 변동과 무관하게 물량 성장을 파악하는 잣대입니다.

IDM: 설계와 생산과 판매를 스스로 수행하는 종합반도체기업. 메모리 산업의 전형적 사업 형태입니다.

파운드리와 팹리스: 위탁 생산 전문 회사와 설계 전문 회사. 분업 구조의 두 기둥이며 HBM4에서 메모리 회사와의 접점이 생겼습니다.

고객 인증: 고객이 공급사 제품을 자사 시스템에서 검증해 승인하는 절차. 통과하지 못하면 매출이 발생하지 않습니다.

장기공급계약: 여러 분기 또는 여러 해의 물량과 가격을 미리 확정하는 계약. 사이클 변동을 완화하는 장치입니다.

판매 및 운영 계획: 수요 전망과 생산 능력을 정기적으로 맞추는 절차. 물량이 부족한 국면에서는 배분 회의의 성격을 갖습니다.

기술 전환: 구세대 공정과 제품에서 신세대로 생산과 판매를 옮기는 작업. 원가 개선과 공급 차질이 함께 걸린 판단입니다.

웨이퍼 잠식: 고부가 제품 생산이 다른 제품에 쓸 웨이퍼를 줄이는 현상. 2026년 공급 부족의 주요 원인입니다.

eSSD: 데이터센터와 서버에 쓰이는 기업용 저장 장치. 인공지능 추론 확산의 수혜 제품군입니다.

QLC: 한 셀에 4비트를 담는 낸드 방식. 대용량과 저원가에 유리해 인공지능 데이터센터에 적합합니다.

메모리 월: 연산 장치 성능을 메모리 속도가 따라가지 못해 생기는 병목. HBM이 등장한 근본 이유입니다.

솔리다임: 인텔 낸드 사업 인수로 설립된 SK하이닉스 자회사. 기업용 저장 장치 영역을 담당합니다.

SKMS와 VWBE와 SUPLEX: SK그룹 경영 체계와 그 안의 자발적 몰입, 최고 수준 추구 개념. 인재상과 조직 운영의 기반입니다.

■ 참고 레퍼런스 (References)

TrendForce 메모리 시장 및 가격 전망 —

심층분석보고서: 26하_SK하이닉스_영업

<https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260202-12911.html>

TrendForce 2027년 메모리 수급 전망 —

<https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260730-13158.html>

Counterpoint Research 글로벌 D램 및 HBM 점유율 —

<https://counterpointresearch.com/en/insights/global-dram-and-hbm-market-share>

Counterpoint Research 글로벌 낸드 점유율 —

<https://counterpointresearch.com/en/insights/global-nand-memory-market-share>

Counterpoint Research SK하이닉스 HBM 이익 기여 분석 —

<https://korea.counterpointresearch.com/sk-hynix-q1-2025-memory-hbm/>

Deloitte 2026 반도체 산업 전망 —

<https://www.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/technology-media-telecom-outlooks/semiconductor-industry-outlook.html>

PwC컨설팅 2026년 반도체 시장 전망 —

<https://www.pwcconsulting.co.kr/ko/insights/semicon-bubble-supercycle.html>

SK하이닉스 뉴스룸 2026년 1분기 경영실적 — <https://news.skhynix.co.kr/q1-2026-business-results/>

SK하이닉스 뉴스룸 2026년 시장 전망 — <https://news.skhynix.co.kr/2026-market-outlook/>

SK하이닉스 뉴스룸 SK AI 서밋 2025 기조연설 — <https://news.skhynix.co.kr/sk-ai-summit-2025/>

SK하이닉스 뉴스룸 HBM에서 eSSD까지 제품 전략 — <https://news.skhynix.co.kr/hbm-to-essd/>

SK하이닉스 뉴스룸 투자 계획 관련 자료 — <https://news.skhynix.co.kr/fact-05/>

SK Careers Journal 마케팅 직무 인터뷰 — <https://www.skcareersjournal.com/2892>

SK Careers Journal 상품기획 직무 인터뷰 — <https://www.skcareersjournal.com/2238>

SK그룹 경영철학 SKMS — <https://www.sk.co.kr/ko/about/skms.jsp>